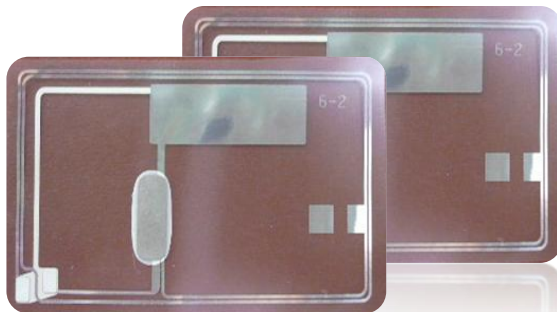


MATERI TRAINING INLET



KRITERIA REJECT



PRODUCTION TRAINING

Produk NG (Not Good) adalah :

Produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen dan biasa disebut dengan REJECT

Kriteria Reject dibagi menjadi dua :

1. CRITICAL REJECT

**adalah Reject yang tidak ada toleransinya (tidak boleh ada reject)
spec : < 1 pcs**

2. NON CRITICAL REJECT

adalah Reject yang masih ada toleransinya (masih diperbolehkan dengan pesifikasi yang sudah ditentukan)

KRITERIA KERUSAKAN PADA MATERIAL

Dalam sebuah proses assembly pada produk semiconductor, jenis – jenis kegagalan atau failures yang menjadi masalah kritis atau critical item adalah :

1. SHORT & LEAK

Kondisi dimana arus dua arus yang dialirkan kedalam chip yang seharusnya terpisah tapi menyatu.

Short dan Leak hanya dibedakan besar kecilnya short yang terjadi.

~ Short terjadinya arus pendek / konsluet

~ Leak terjadinya arus bocor / short kecil

2. OPEN

Kondisi dimana arus yang seharusnya mengalir masuk ke chip / keluar dari chip tidak terjadi, karena koneksinya terputus.

3. RELIABILITY

Kondisi kerusakan pada package yang dapat merusak fungsi baik secara langsung ataupun dalam jangka waktu tertentu terputus.

4. KOSMETIK

Kondisi penampilan package mengalami kerusakan baik mempengaruhi atau tidak terhadap fungsi dari produk tersebut.

Penulisan reject pada lot sheet dibagi menjadi dua :

- 1. Reject 1 adalah reject yang langsung dibuang di area tersebut / yang bersangkutan.**
- 2. Reject 2 adalah reject yang tidak langsung dibuang (hanya diberi tanda) sedangkan aktual materialnya ikut ke proses selanjutnya.**

PENANGANAN PADA MATERIAL REJECT

JENIS	TANDA	GAMBAR
DUMMY	Diberikan marker di bagian die pad	
REJECT 1	N / A	N / A
REJECT 2	Ada bad mark warna hitam, hijau dan biru	

Reject Criteria COF

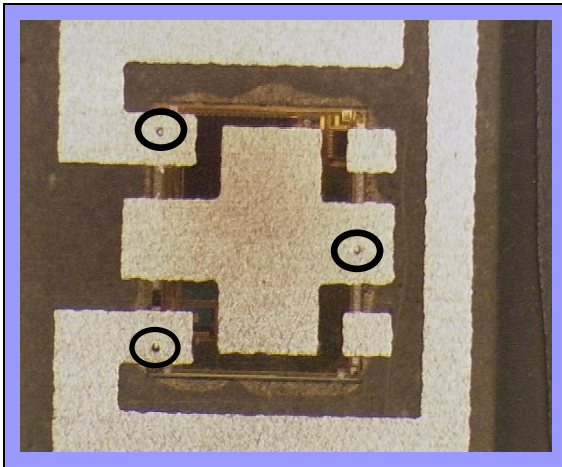
KRITERIA REJECT COF

1. BUMB MARK CONDITION

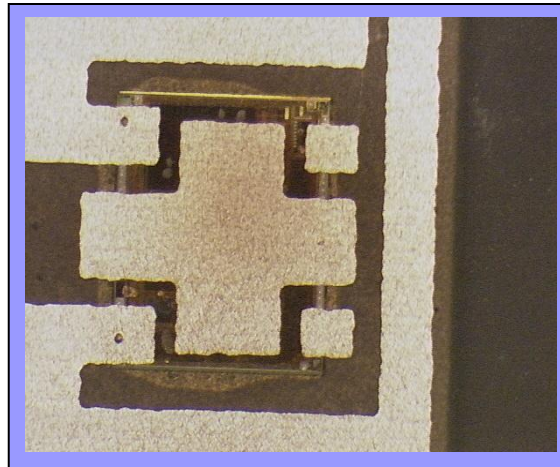
Adalah Pemeriksaan pada kondisi / letak dari bumb mark

Spesifikasinya :

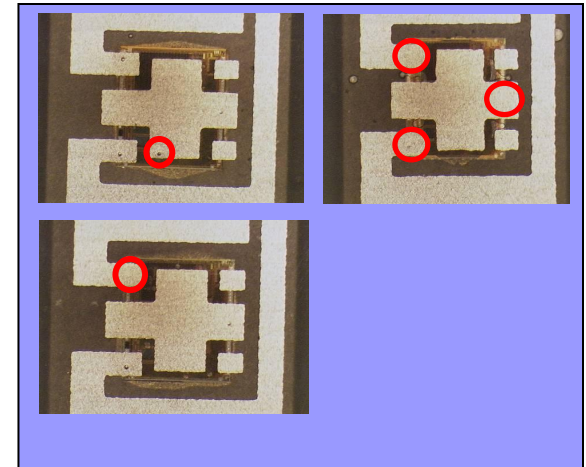
Tidak diijinkan adanya bumb mark selain di area VA, VB, dan VSS



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

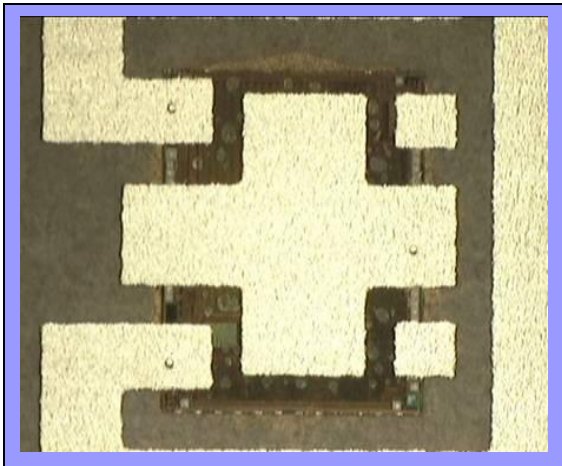
Terdapat bumb mark di area selain VA, VB atau VSS, tidak terdapat bumb mark di area VA atau VB, tidak terdapat bumb mark di area VA, VB atau VSS

2. BUMB MARK POSITION

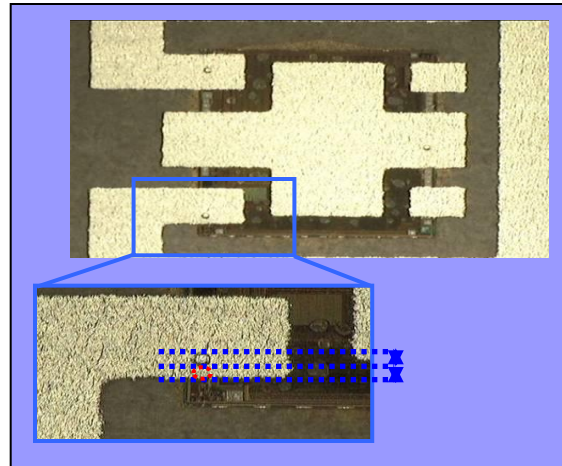
Adalah Pemeriksaan pada kondisi / letak dari bumb mark

Spesifikasinya :

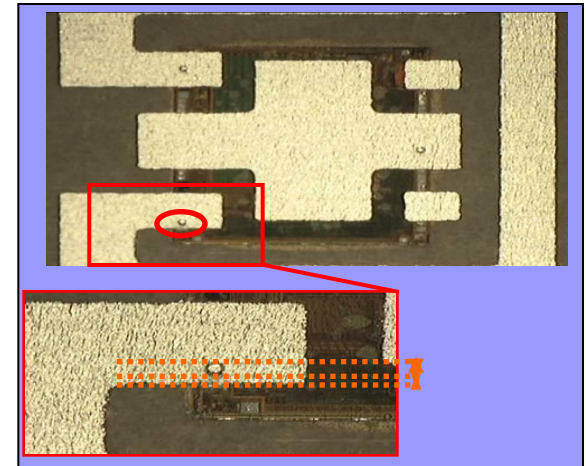
Tidak diijinkan jika posisi bumb mark kurang dari 1x lebar bumb mark dari sisi aluminium pattern



KONDISI "OK"



MARGINAL



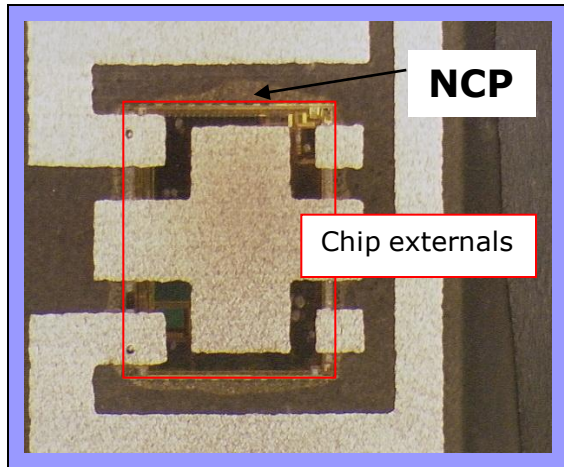
KONDISI "NG"

3. NCP FILLING

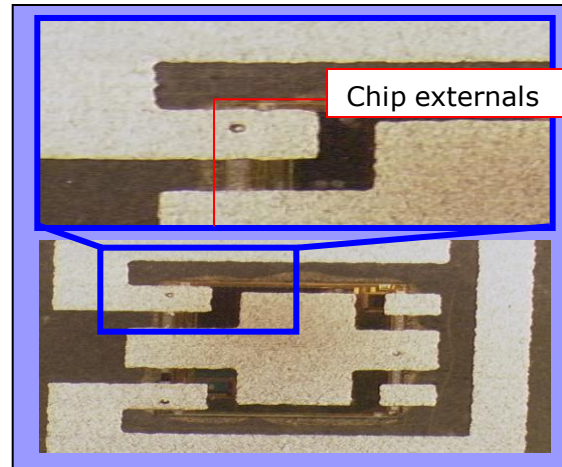
Adalah Pemeriksaan kondisi NCP pada area permukaan chip

Spesifikasinya :

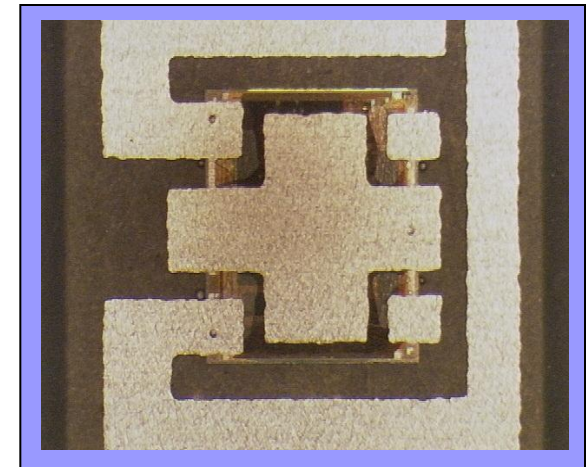
Tidak diijinkan jika tidak ada NCP di permukaan chip, dan jumlah NCP tidak memenuhi seluruh area chip / pojokan chip tidak terdapat NCP



KONDISI "OK"



MARGINAL



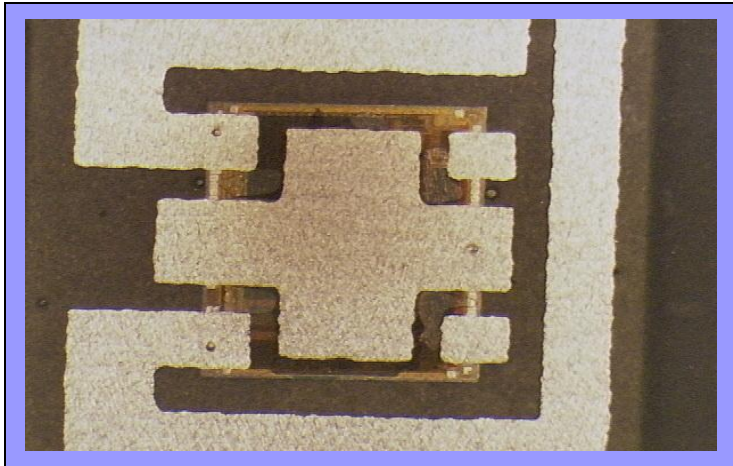
KONDISI "NG"

3. NCP FILLING

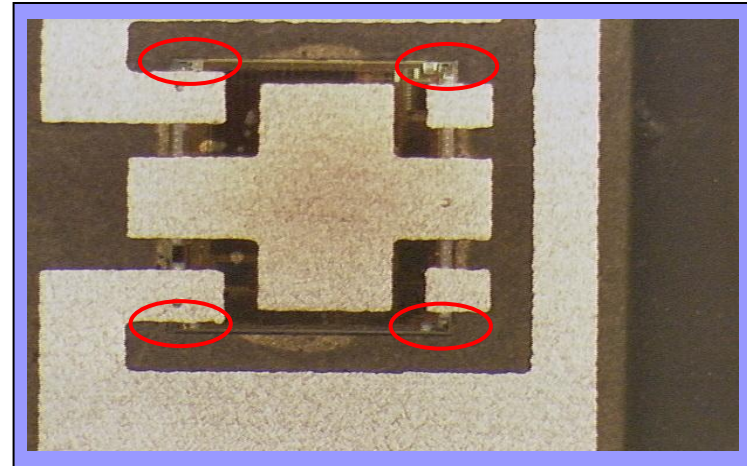
Adalah Pemeriksaan kondisi NCP pada area permukaan chip

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NCP di permukaan chip, dan jumlah NCP tidak memenuhi seluruh area chip / pojokan chip tidak terdapat NCP



KONDISI "NG"



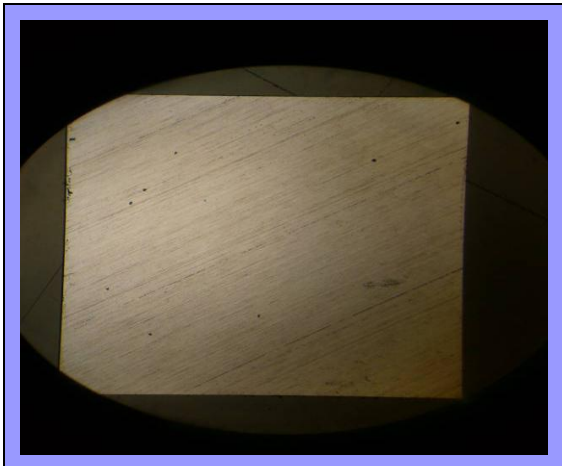
KONDISI "NG"

4. TOOLMARK CHIP BACKSIDE

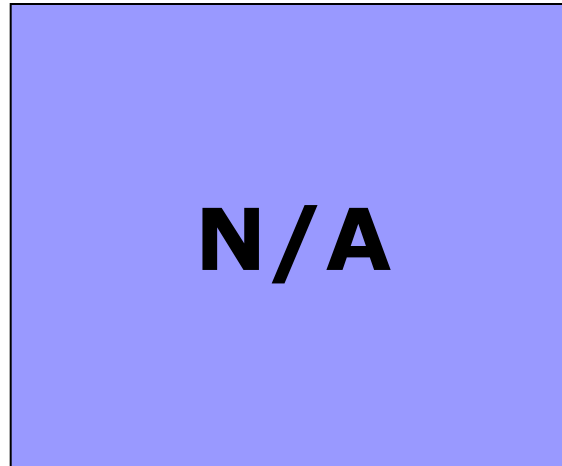
Adalah Pemeriksaan needle toolmark pada chip bagian belakang

Spesifikasinya :

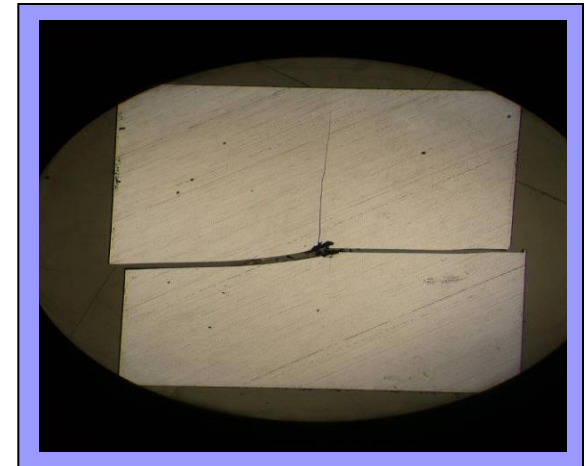
Tidak diijinkan adanya toolmark pada chip ataupun chip crack



KONDISI "OK"



MARGINAL



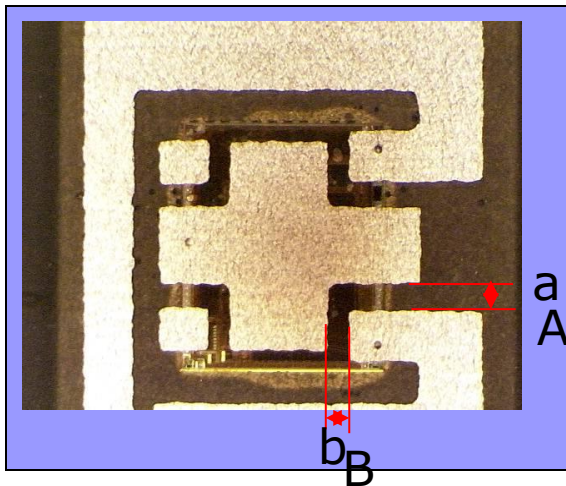
KONDISI "NG"

5. NCP VOID

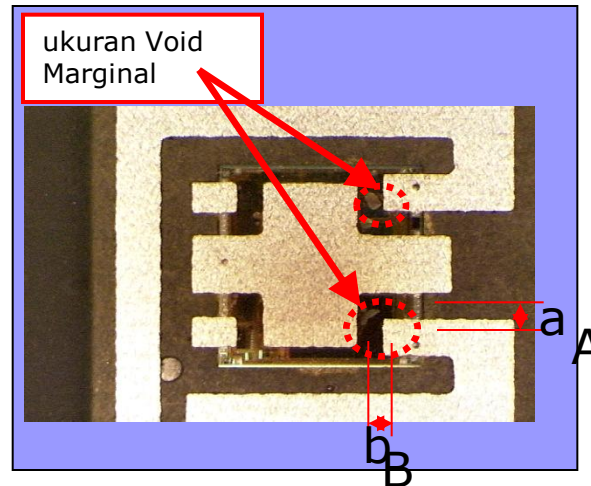
Adalah Terperangkapnya udara pada permukaan chip pada saat proses NCP dispense

Spesifikasinya :

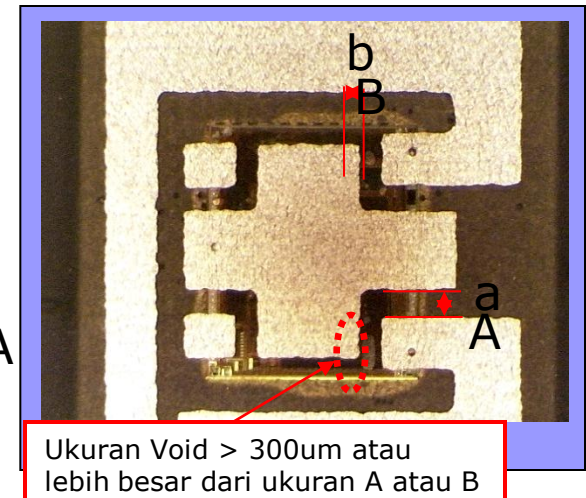
Tidak diijinkan adanya void $> 300\mu\text{m}$ pada area NCP / ukuran void lebih besar dari ukuran A atau B



KONDISI "OK"



MARGINAL



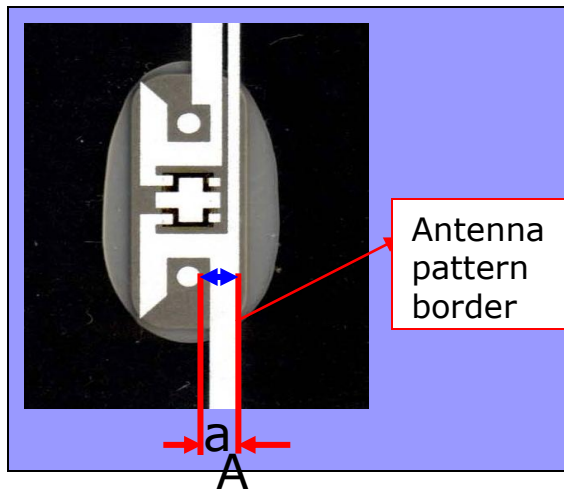
KONDISI "NG"

6. GLUE FILET

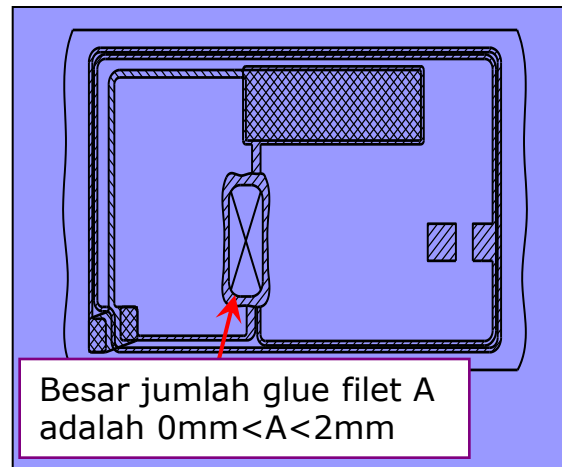
Adalah Pemeriksaan penyebaran glue paste pada area aluminium pattern

Spesifikasinya :

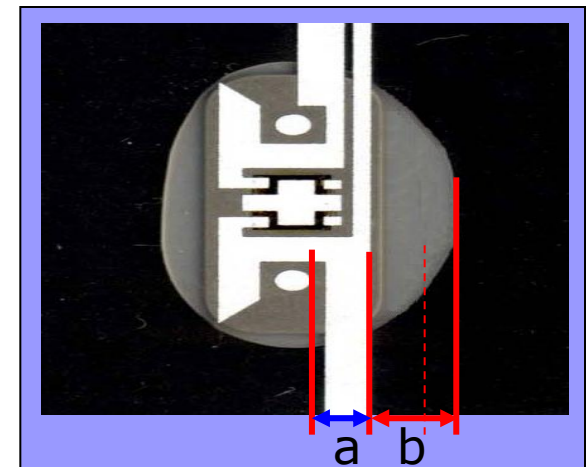
Tidak diijinkan jika jarak $B > A$ atau 2mm



KONDISI "OK"



MARGINAL



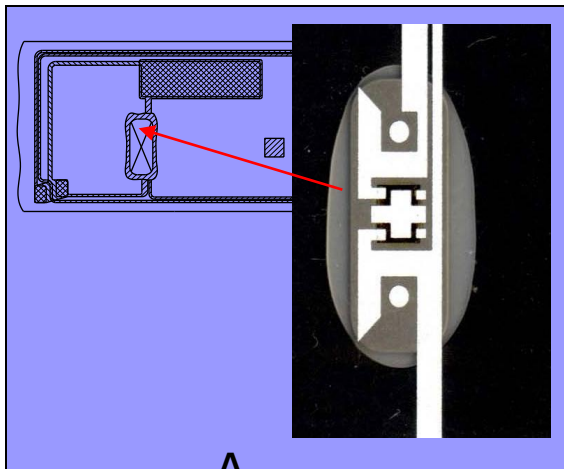
KONDISI "NG"

7. INSUFFICIENT GLUE FILET

Adalah Kekurangan glue paste

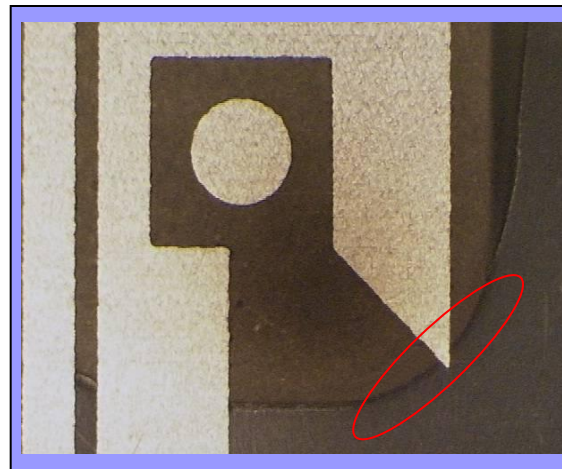
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika glue tidak terisi di tepian / ujung support plate

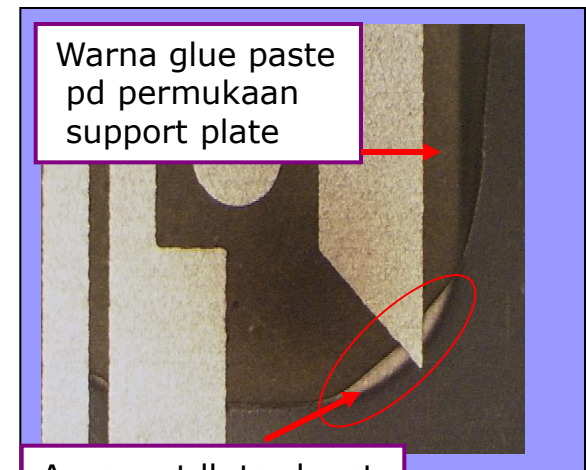


A

KONDISI "OK"



MARGINAL



Warna glue paste
pd permukaan
support plate

Area yg tdk terdapat
glue paste pada tepi
support plate

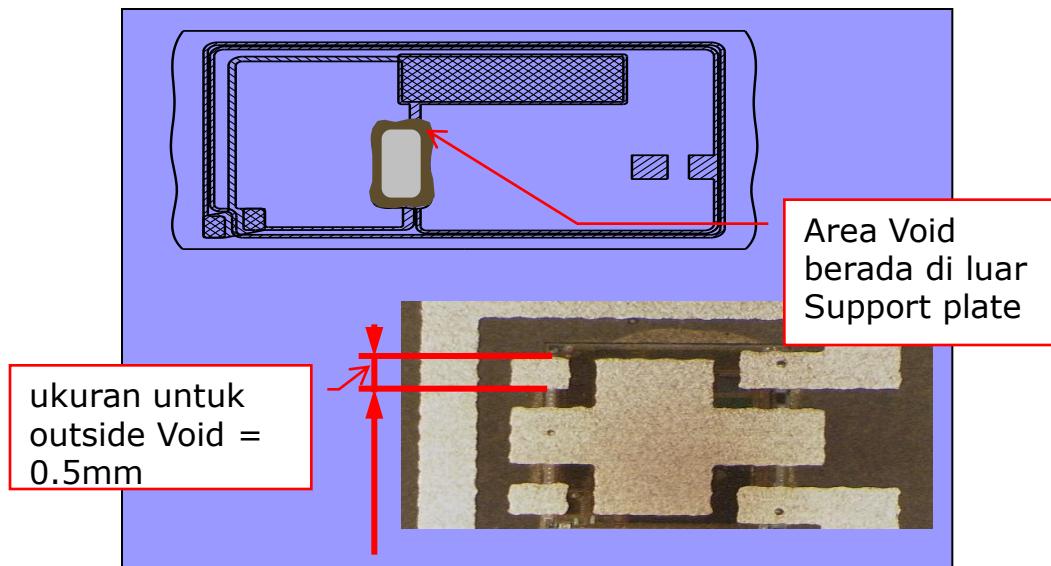
KONDISI "NG"

8. GLUE VOID OUTSIDE SUPPORT PLATE

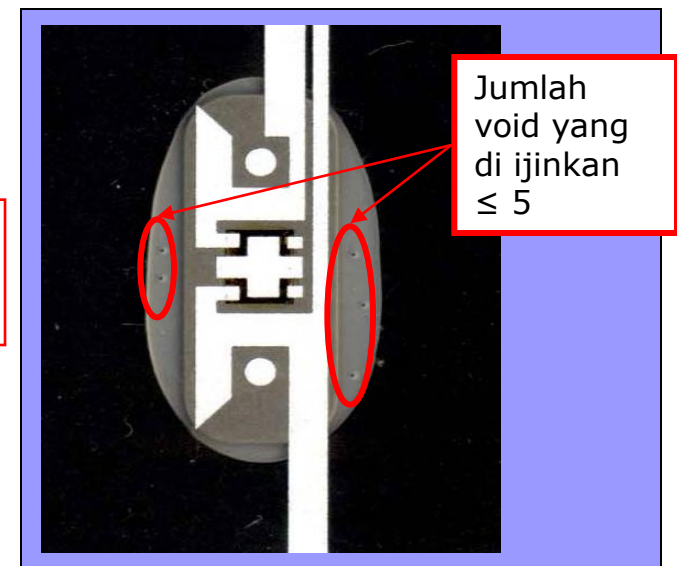
Adalah Void yang terdapat diluar area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $> 3\text{mm}$ dan di dalam area support plate



KONDISI "OK"



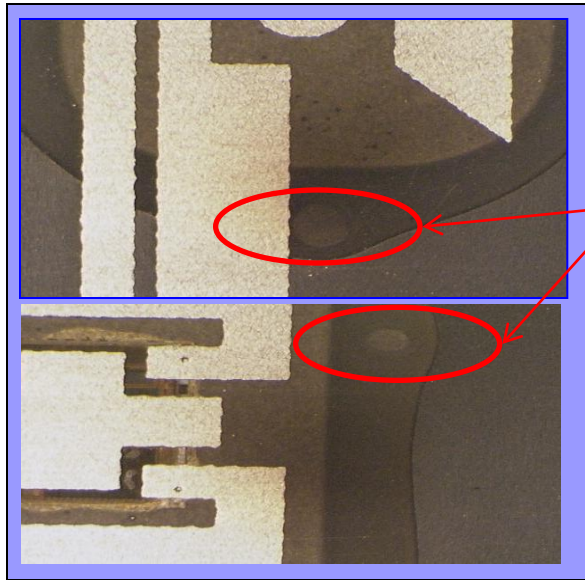
MARGINAL

8. GLUE VOID OUTSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void yang terdapat diluar area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $> 3\text{mm}$ dan di dalam area support plate



Posisi Void berada di
luar Support Plate dan
Ukurannya $> 0.5\text{mm}$

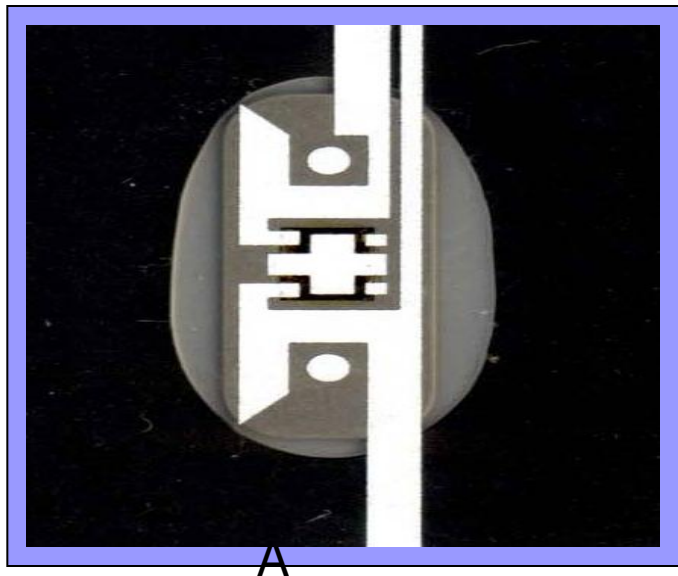
KONDISI "NG"

9. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA I)

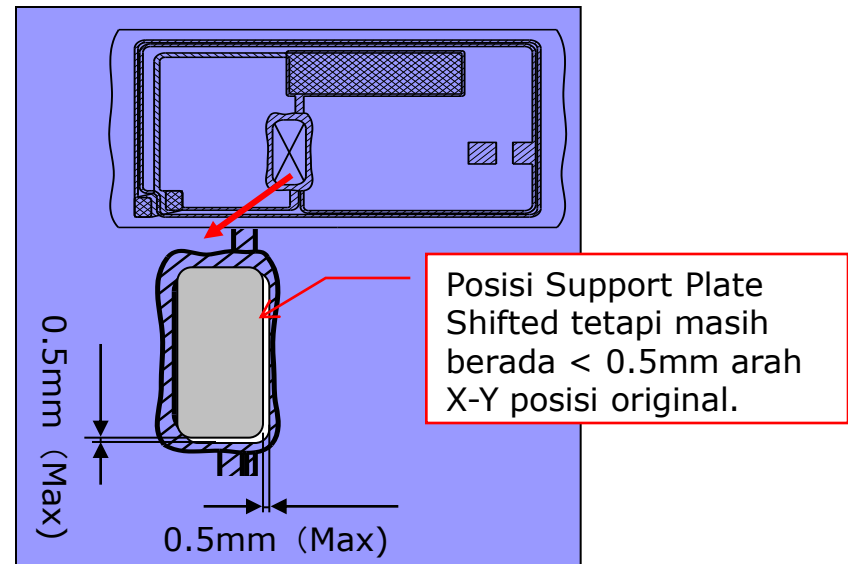
Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
 $\leq 0.5\text{mm}$



KONDISI "OK"



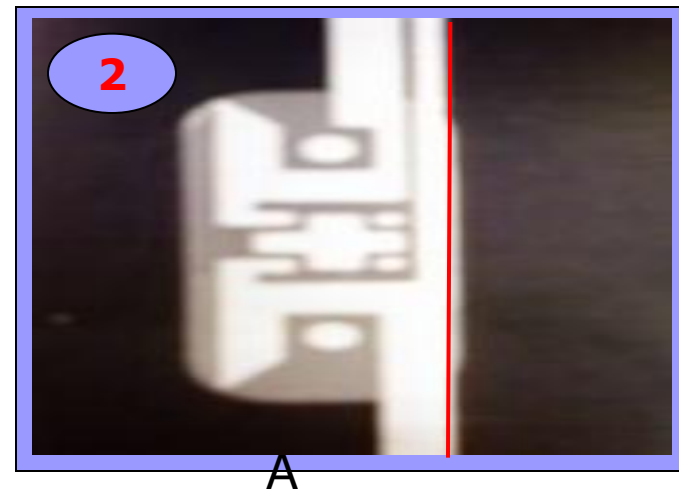
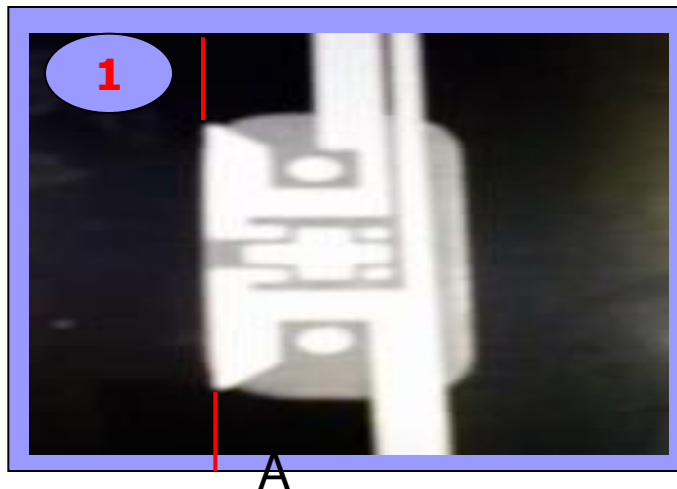
MARGINAL

9. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA I)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
 $\leq 0.5\text{mm}$



KONDISI "NG"

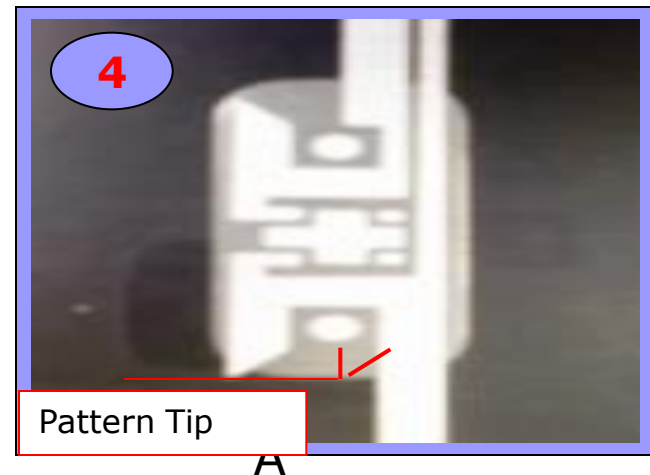
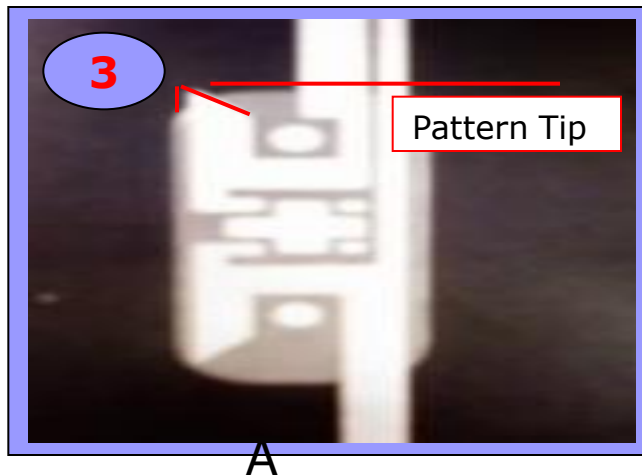
Posisi support plate shifted ke arah X (kanan / kiri)
melebihi garis pattern AL

9. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA I)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
 $\leq 0.5\text{mm}$



KONDISI "NG"

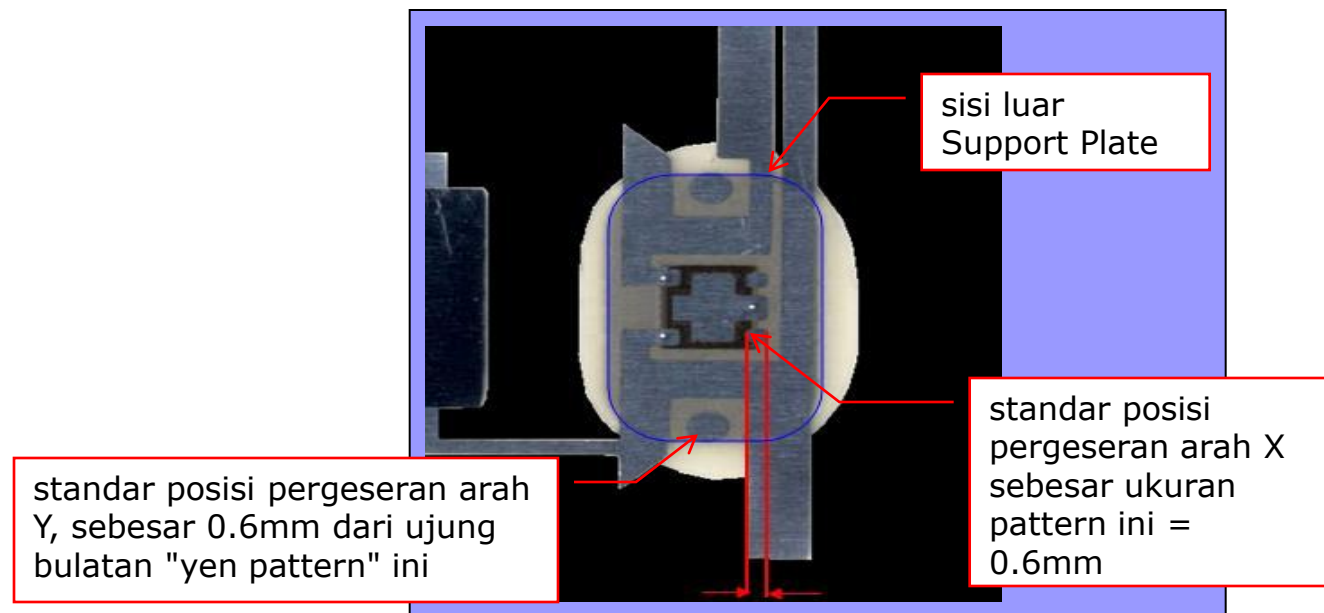
Posisi support plate shifted ke arah Y (atas / bawah)
melebihi garis pattern AL

10. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA II)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
> 0.6mm



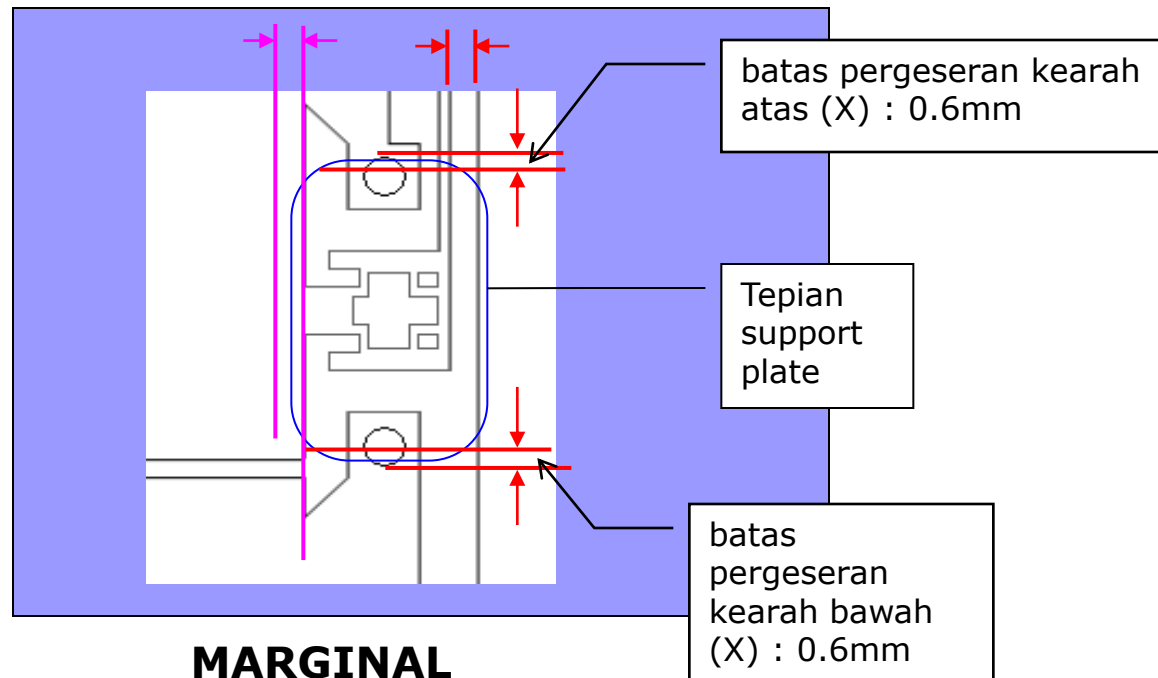
KONDISI "OK"

10. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA II)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
> 0.6mm

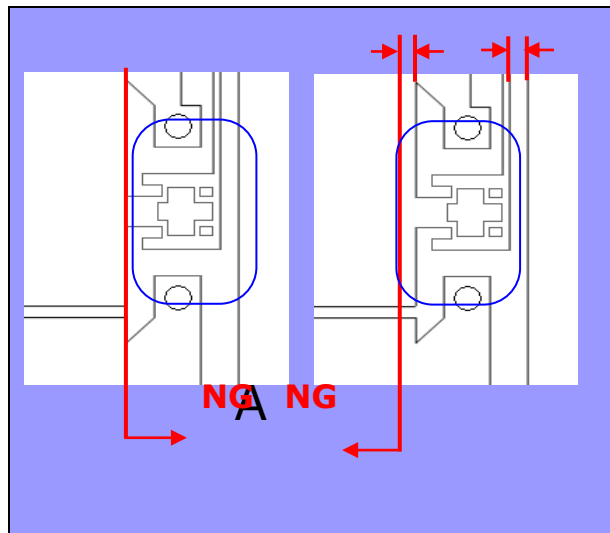


10. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA II)

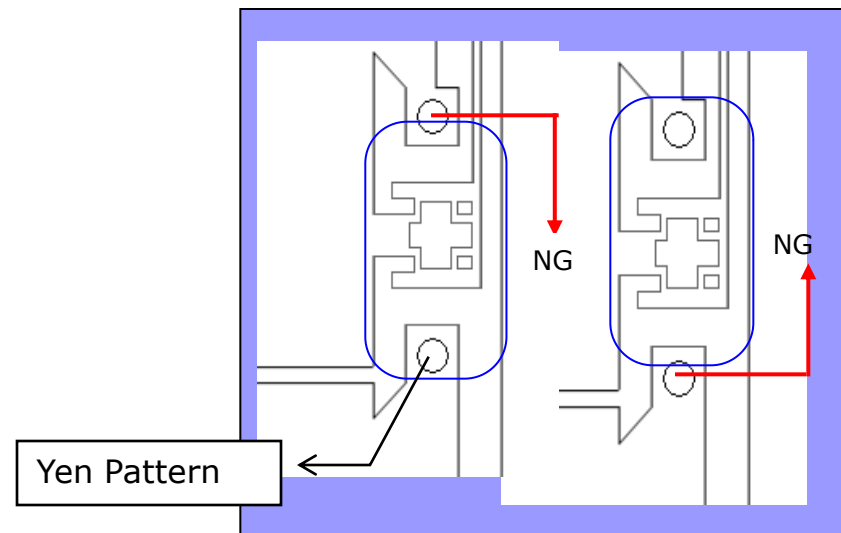
Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi support plate shifted ke arah X atau Y
> 0.6mm



Gbr 1. shifted to X direction



Gbr 1. shifted to Y direction

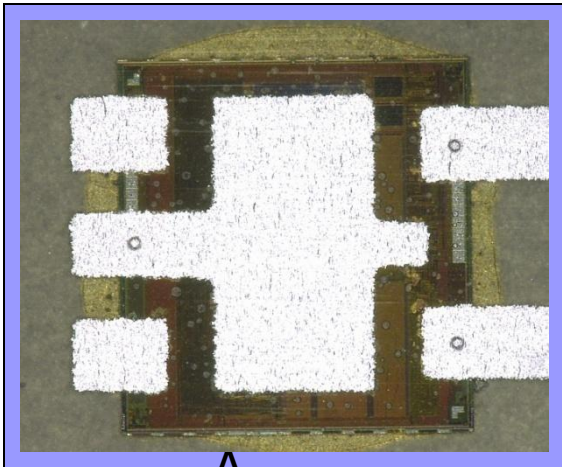
KONDISI "NG"

11. CHIP CRACK

Adalah Adanya keretakan pada permukaan chip

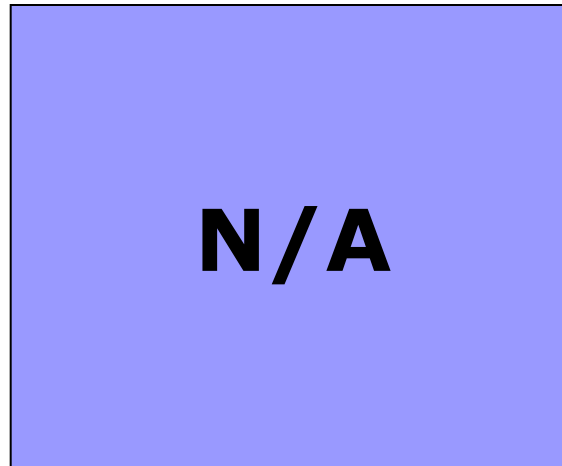
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya chip crack pada permukaan chip

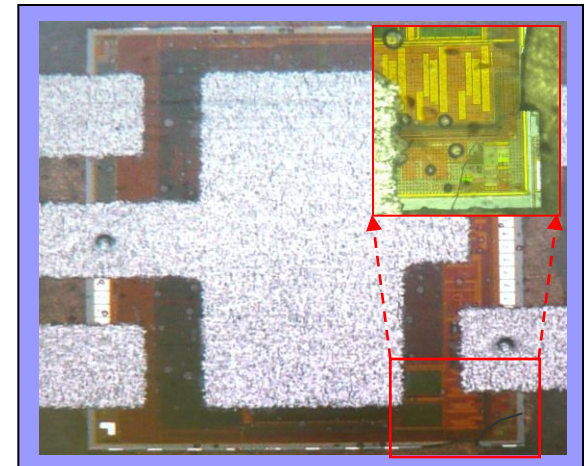


A

KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

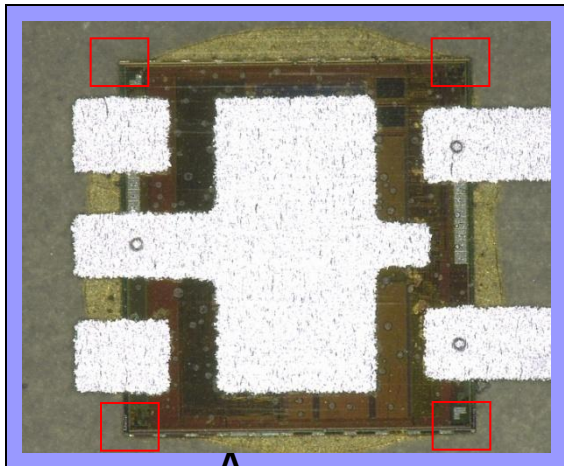
Ditemukan chip crack di permukaan chip

12. CHIPPING CORNER

Adalah Adanya gompelan pada ujung – ujung chip

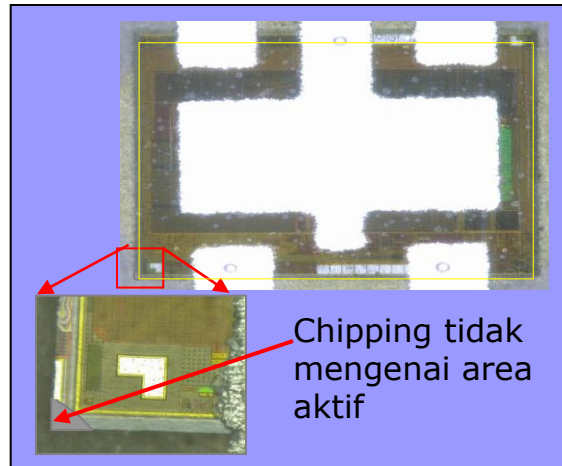
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya chip crack pada permukaan chip



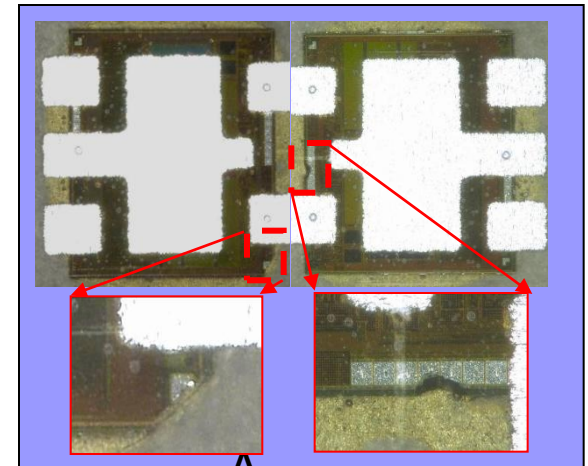
A

KONDISI "OK"



Chipping tidak mengenai area aktif

MARGINAL



A

KONDISI "NG"

Chipping corner sudah mengenai permukaan chip area aktif

Reject Criteria Visual Inspection

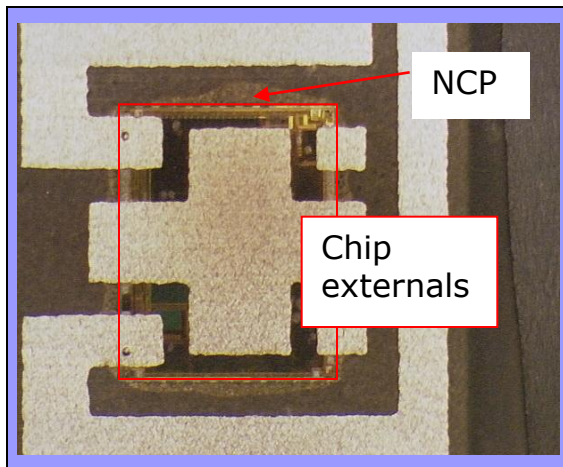
KRITERIA REJECT VISUAL INSPECTION

1. NCP UNFILLED

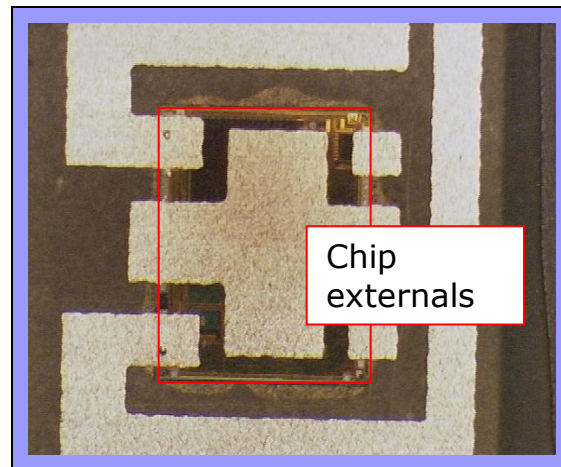
Adalah Kekurangan NCP pada permukaan chip

Spesifikasinya :

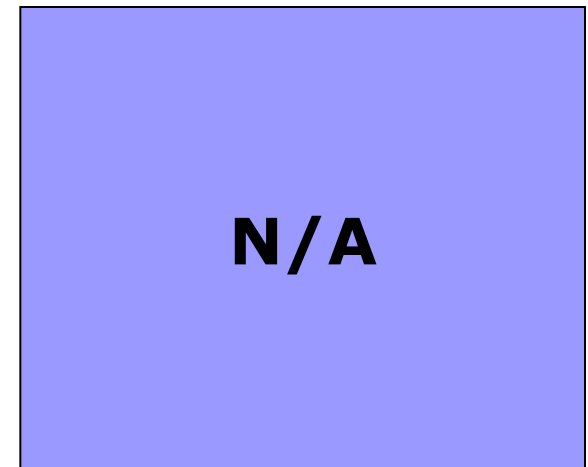
Tidak diijinkan jika NCP tidak memnuhi permukaan chip



KONDISI "OK"



MARGINAL

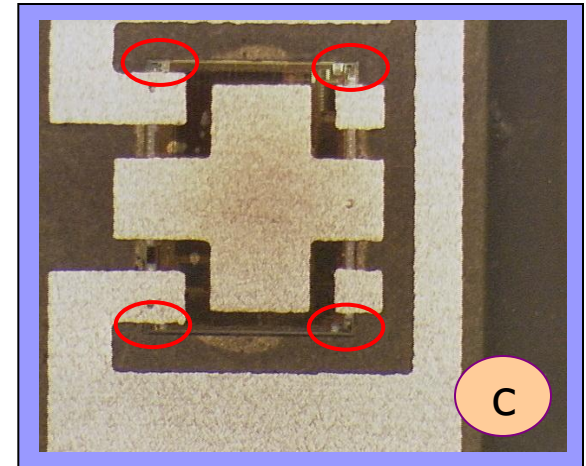
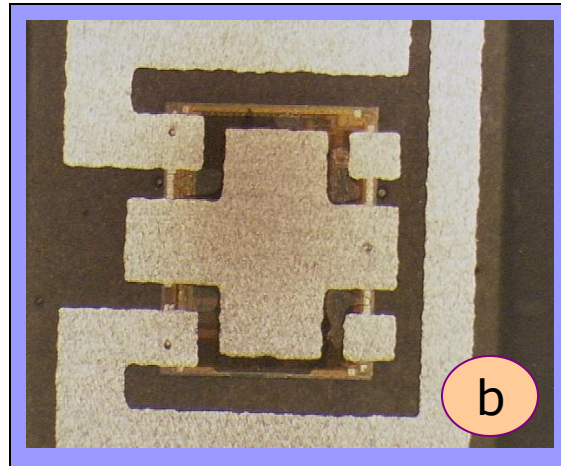
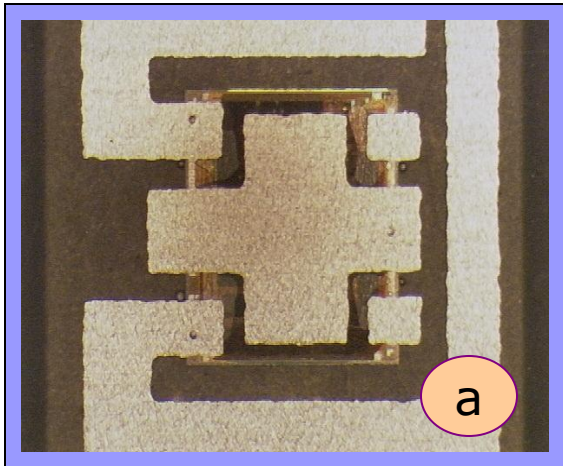


1. NCP UNFILLED

Adalah Kekurangan NCP pada permukaan chip

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika NCP tidak memenuhi permukaan chip



KONDISI "NG"

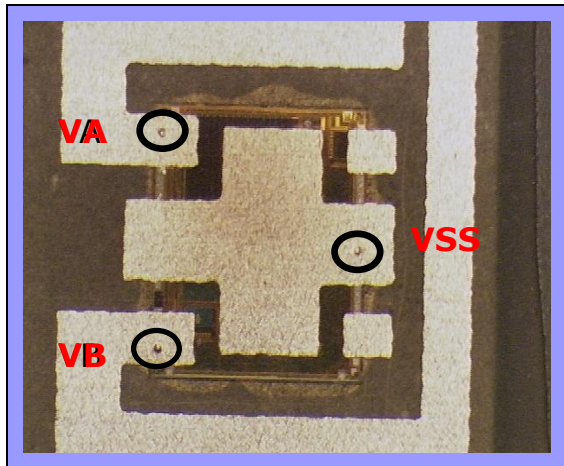
Dikatakan NG jika tidak terdapat NCP pada permukaan chip (a & b) dan jumlah dari NCP tidak memenuhi seluruh area chip / area pojokan chip tidak terdapat NCP (c)

2. BUMB MARK POS (CONDITION)

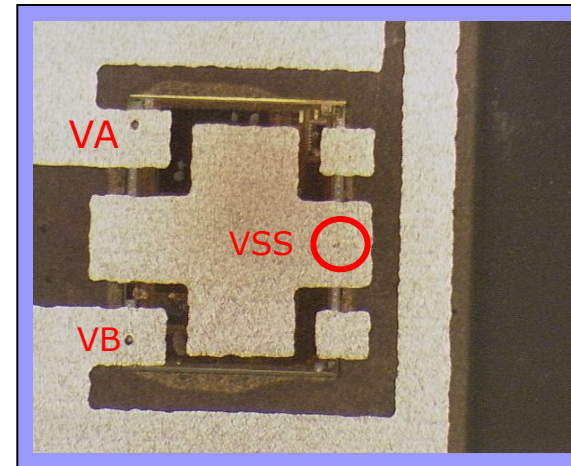
Adalah Tidak adanya bumb mark

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak terdapat bumb pada permukaan chip



KONDISI "OK"

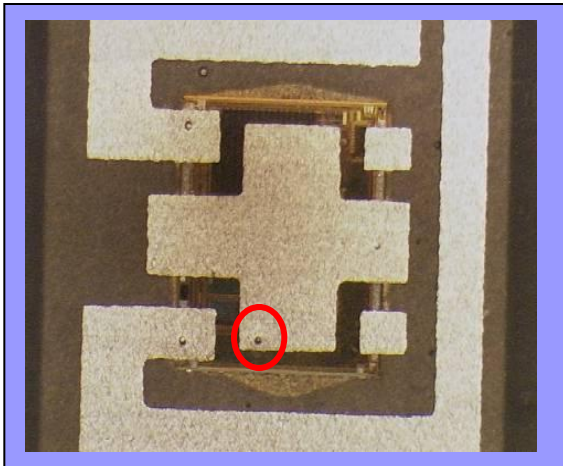


MARGINAL

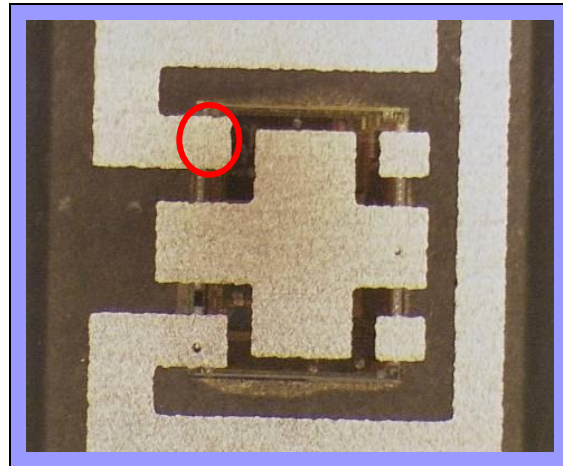
2. BUMB MARK POS (CONDITION) Adalah Tidak adanya bumb mark

Spesifikasinya :

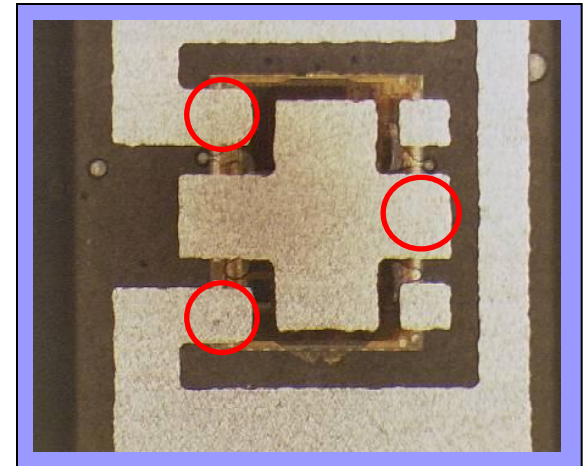
Tidak diijinkan jika tidak terdapat bumb pada permukaan chip



Terdapat bumb mark di area selain VA, VB, atau VSS



Tidak terdapat bumb di area VA atau VB



Tidak terdapat bumb mark di area VB, VA atau VSS

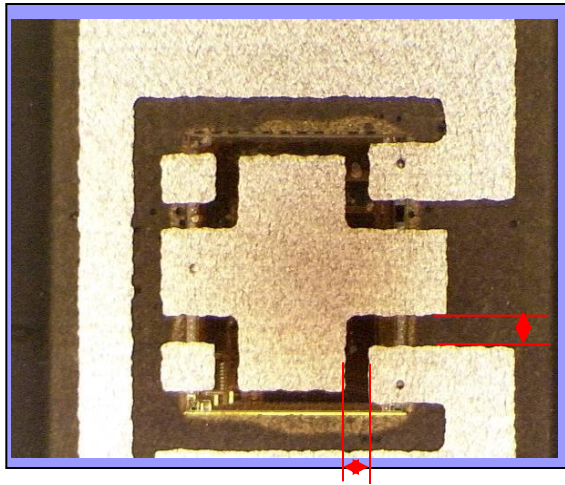
KONDISI "NG"

2. NCP VOID

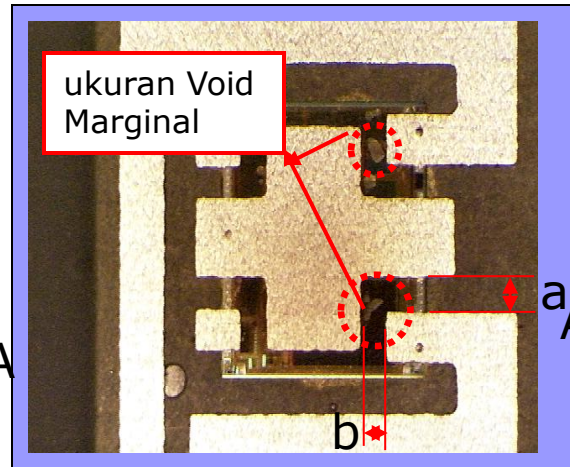
Adalah Terperangkapnya udara pada permukaan chip pada saat proses NCP dispense

Spesifikasinya :

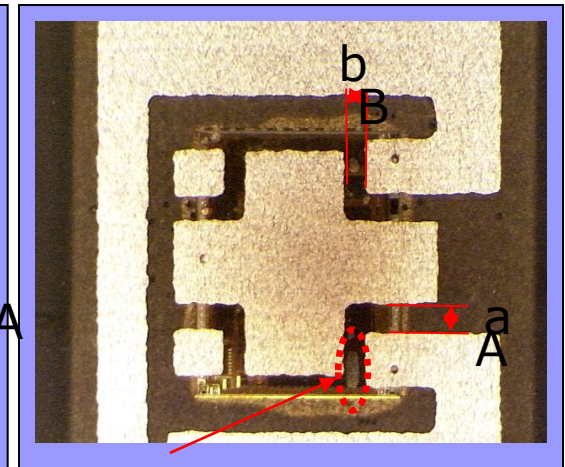
Tidak diijinkan jika void $\geq 300\mu\text{m}$



KONDISI "OK"



MARGINAL"



Ukuran Void $\geq 300\mu\text{m}$ atau lebih besar dari ukuran A atau B

KONDISI "NG"

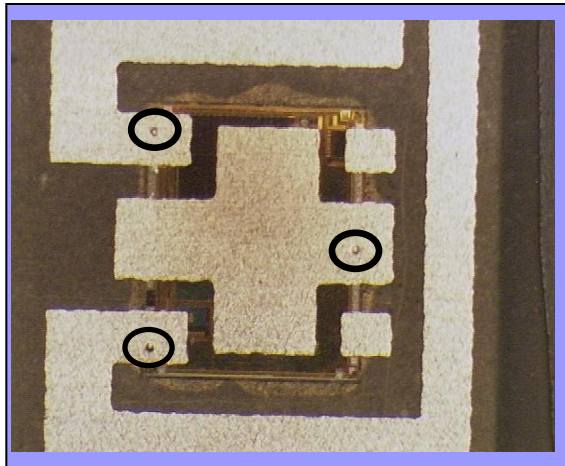
Dikatakan NG jika ukuran Void $\geq 300\mu\text{m}$ atau lebih besar dari ukuran A atau B.

3. FOREIGN MATERIAL AG

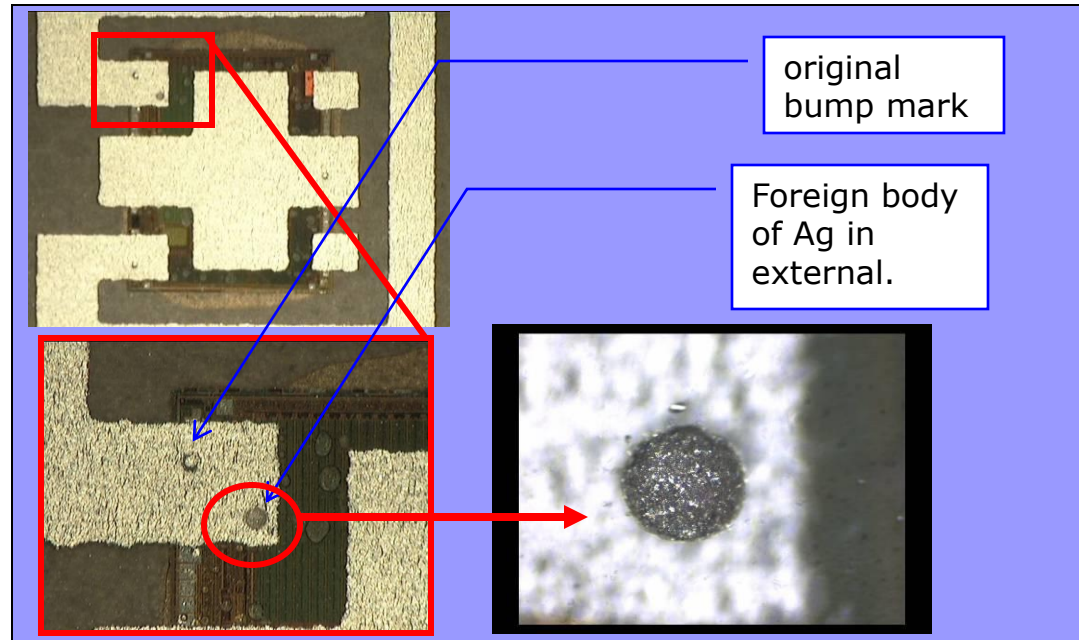
Adalah Adanya benda asing yang menempel pada area bump mark

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya Foreign Material di area bump mark



KONDISI "OK"



KONDISI "NG"

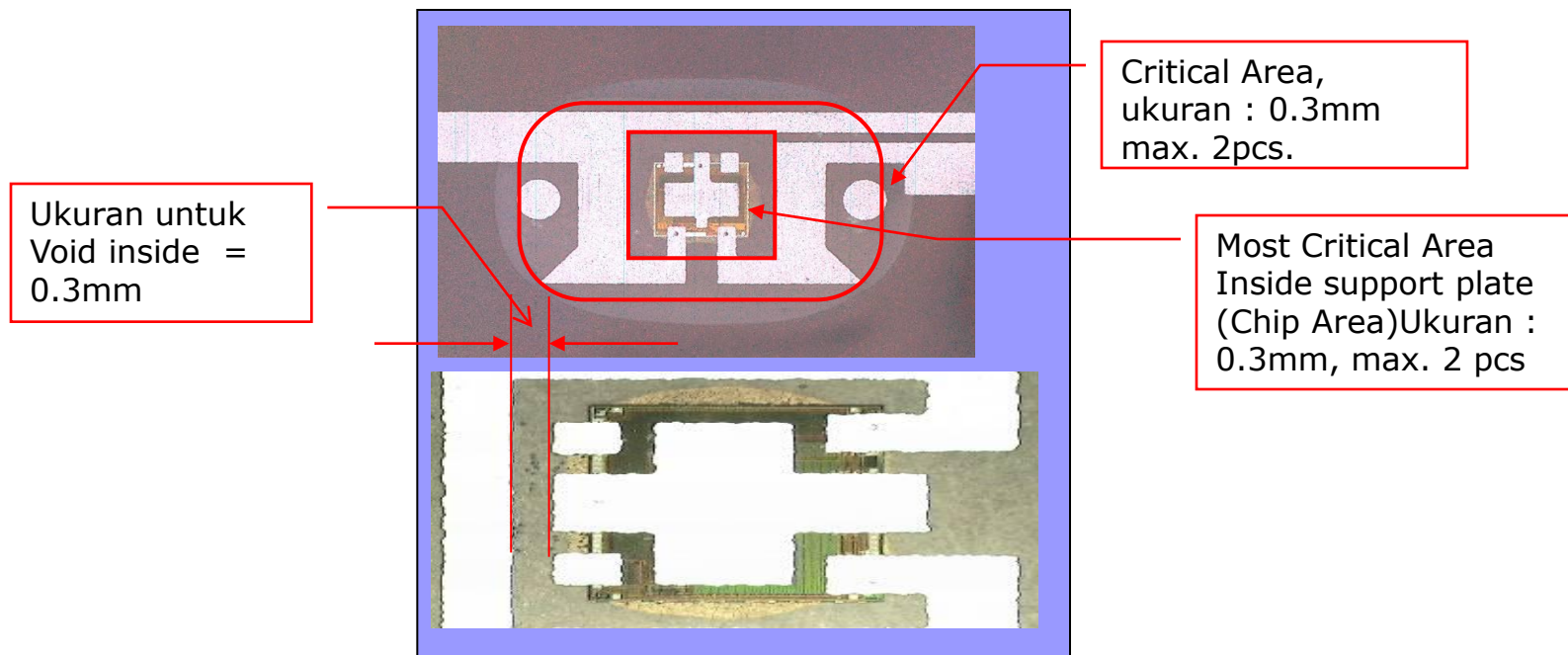
Ditemukan Ag Foreign body pada area bump mark.

4. GLUE VOID INSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di dalam area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.3\mu\text{m}$ dan berada di dalam area support plate



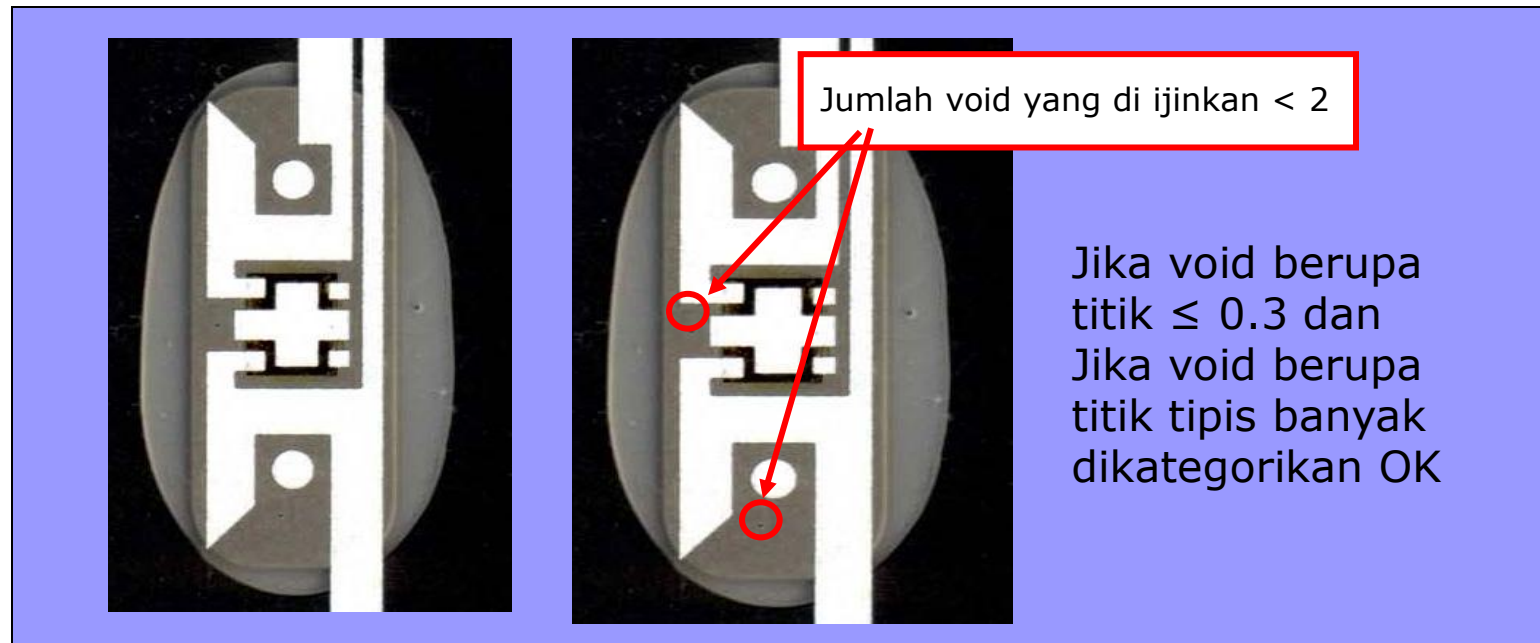
KONDISI "OK"

4. GLUE VOID INSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di dalam area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.3\mu\text{m}$ dan berada di dalam area support plate



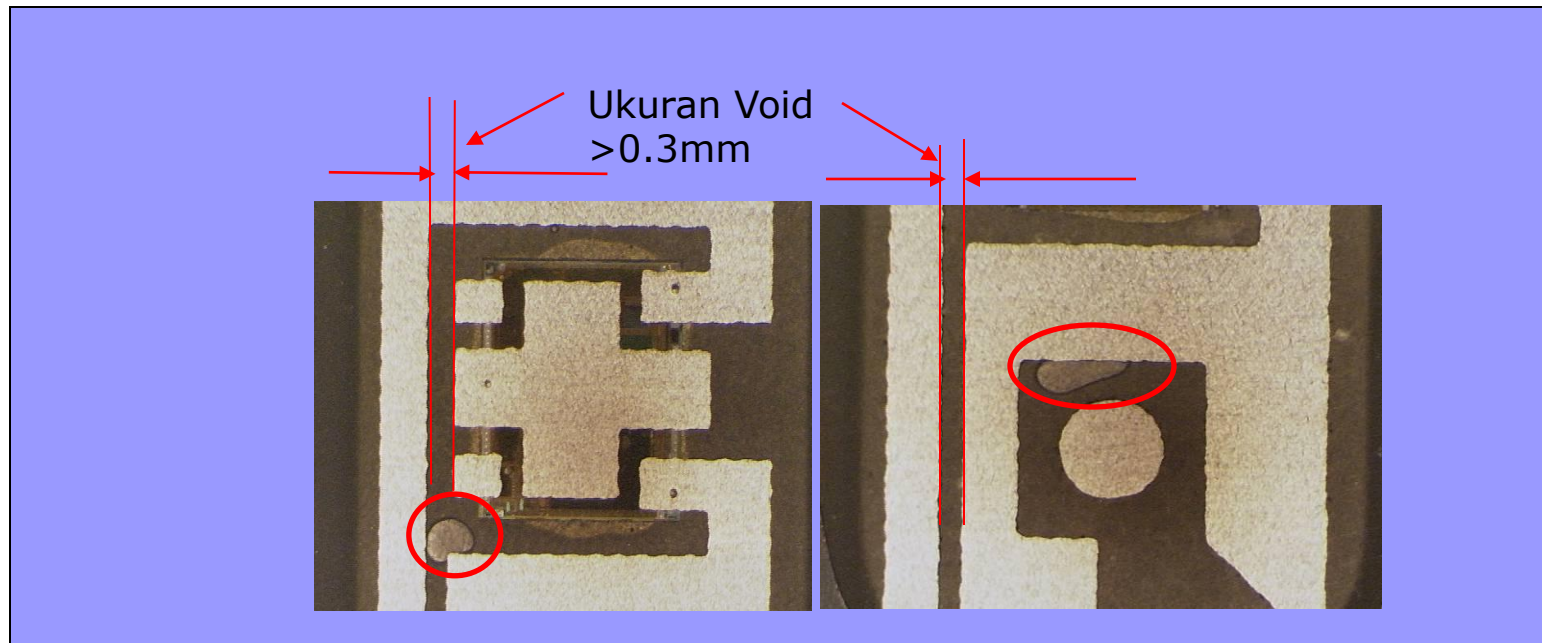
MARGINAL

4. GLUE VOID INSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di dalam area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.3\mu\text{m}$ dan berada di dalam area support plate



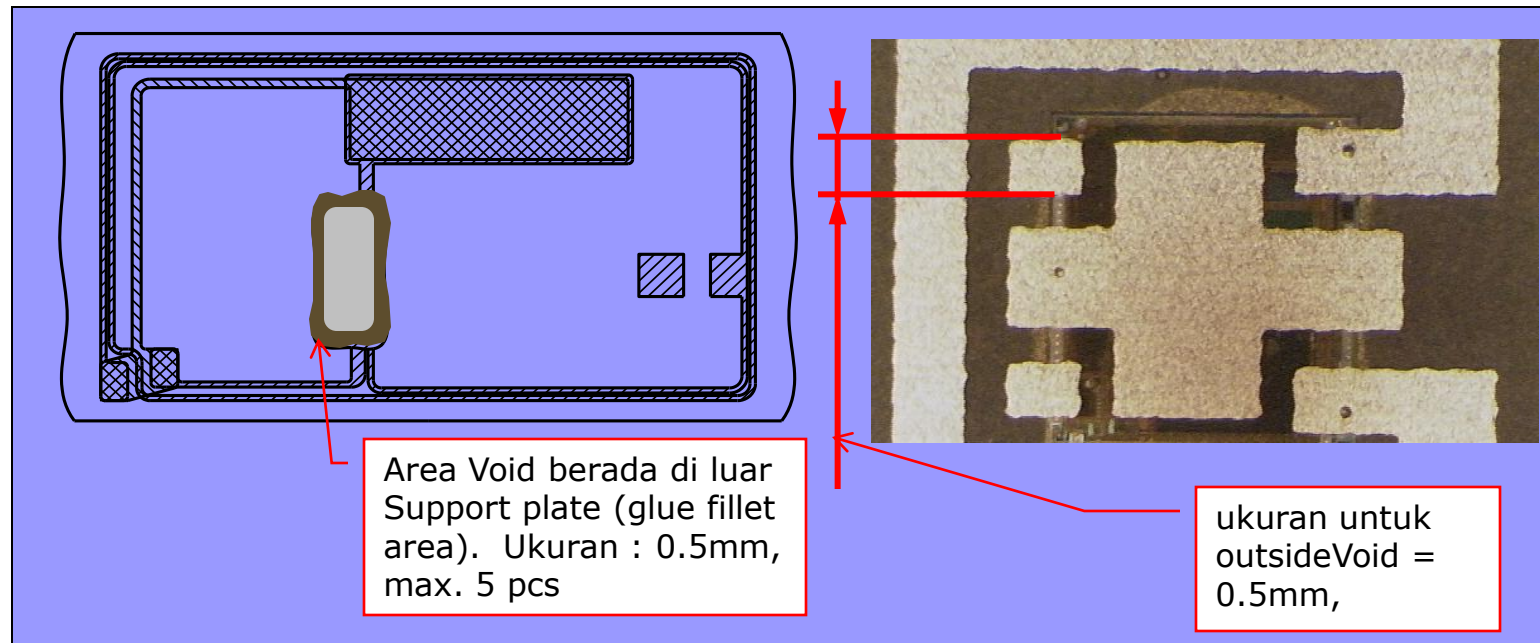
KONDISI "NG"

5. GLUE VOID OUTSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di luar area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.5\mu\text{m}$ dan berada di luar area support plate serta jumlahnya $\geq 5\text{pcs}$



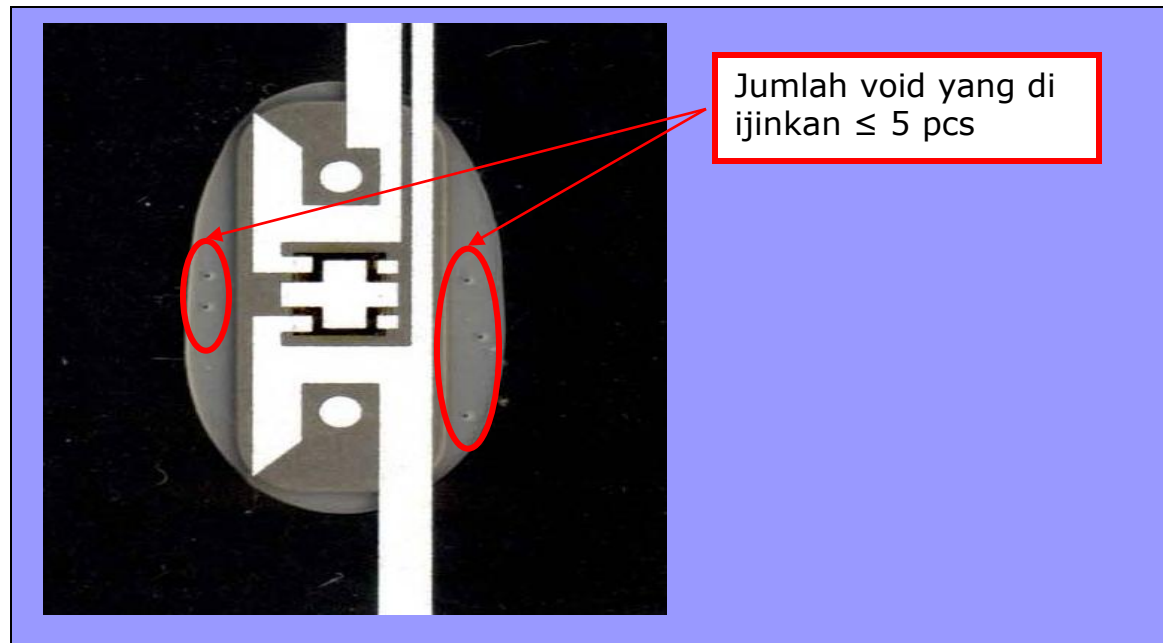
KONDISI "OK"

5. GLUE VOID OUTSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di luar area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.5\mu\text{m}$ dan berada di luar area support plate serta jumlahnya $\geq 5\text{pcs}$



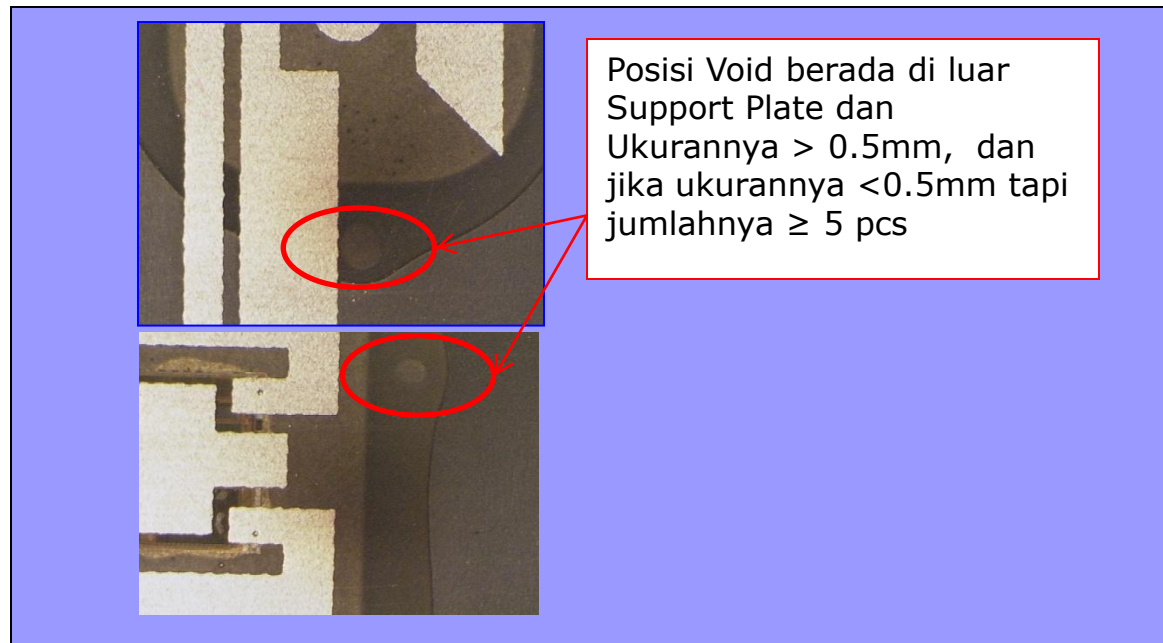
MARGINAL

5. GLUE VOID OUTSIDE SUPPORT PLATE

Adalah Void / lubang yang terdapat di luar area support plate

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada void $\geq 0.5\mu\text{m}$ dan berada di luar area support plate serta jumlahnya $\geq 5\text{pcs}$



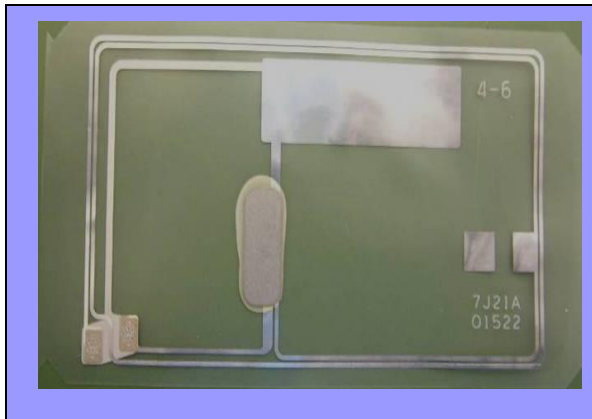
KONDISI"NG"

6. BLOCKING BRISTLE TAIL

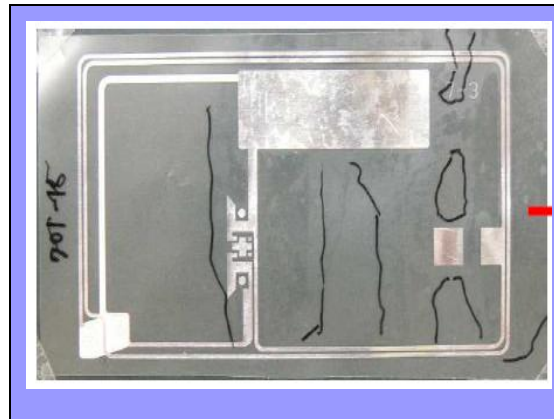
Adalah adanya kotoran yang berbentuk bulu / rambut pada antenna sheet

Spesifikasinya :

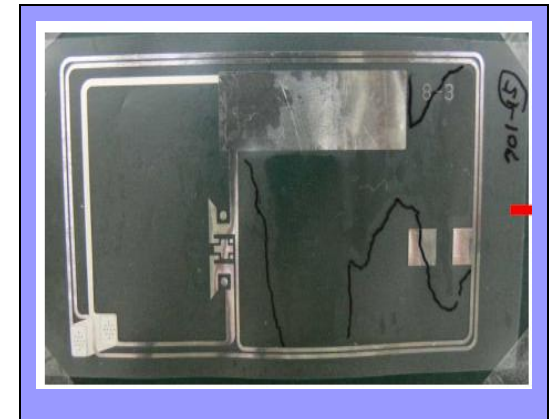
Tidak diijinkan adanya blocking tail yang terlihat jelas



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

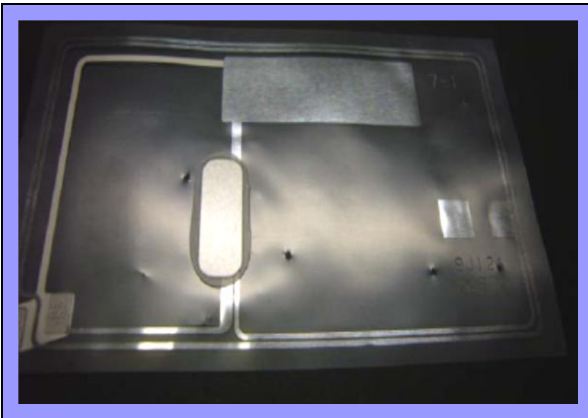
Terdapat blocking bristle tail pada permukaan sheet.

7. BRISTLE TAIL

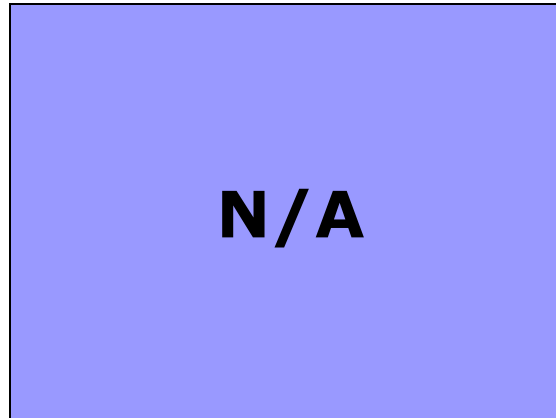
Adalah adanya kotoran yang berbentuk bulu / rambut pada antenna sheet

Spesifikasinya :

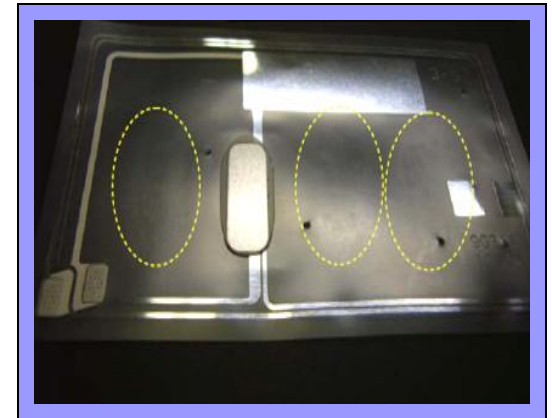
Tidak diijinkan adanya bristle tail yang terlihat jelas pada permukaan antenna sheet



KONDISI"OK"



MARGINAL



KONDISI"NG"

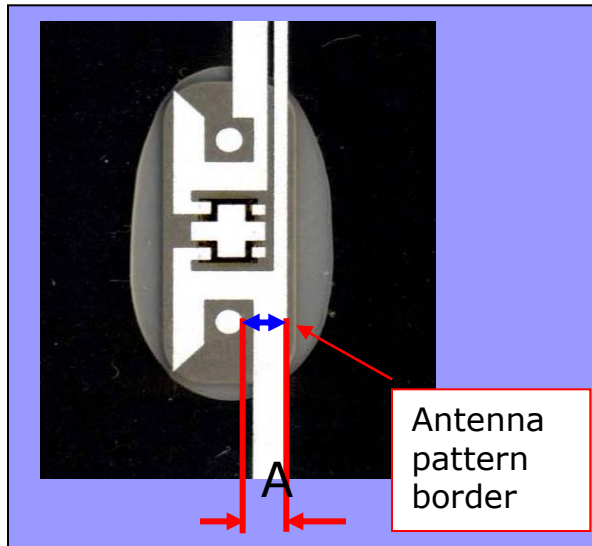
Ditemukan bristle tail pada permukaan sheet
Pemeriksaan menggunakan naked eye secara langsung pada unit

8. GLUE PASTE (GLUE FILET)

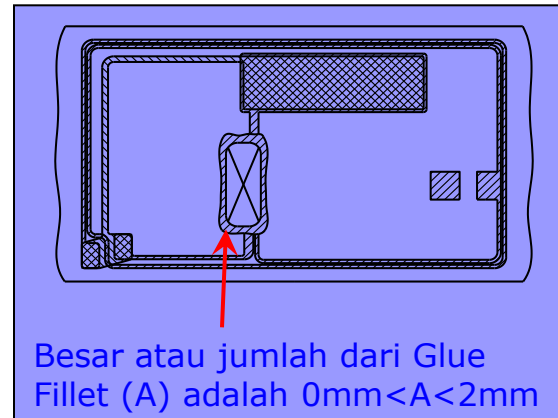
Adalah Penyebaran glue paste di area support plate

Spesifikasinya :

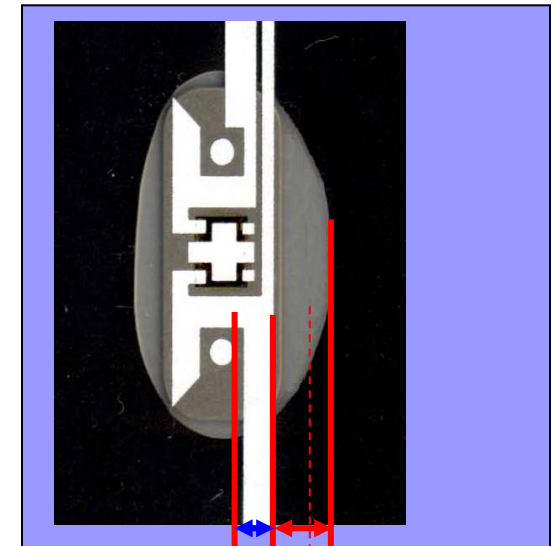
Tidak diijinkan adanya glue filet $> 2\text{mm}$



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

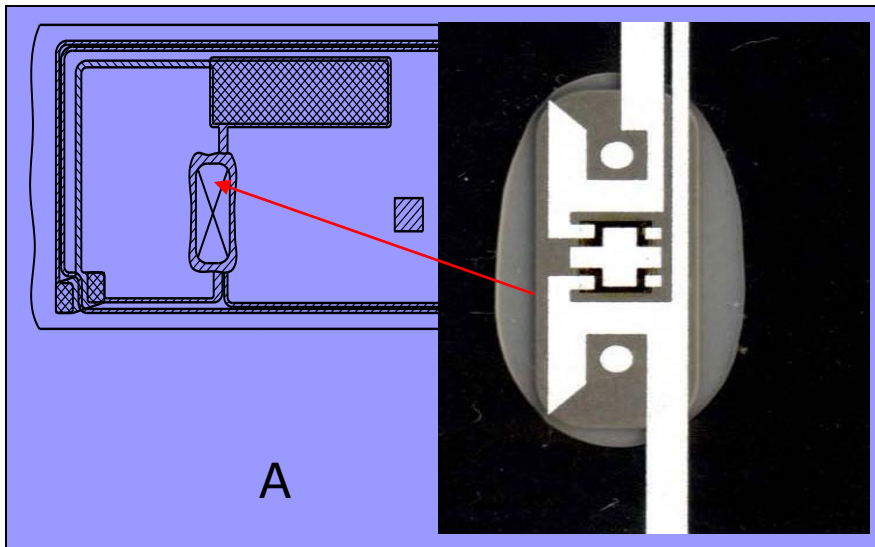
Dikatakan NG jika jarak $B > A$ atau melebihi 2mm

9. GLUE PASTE INSUFFICATION

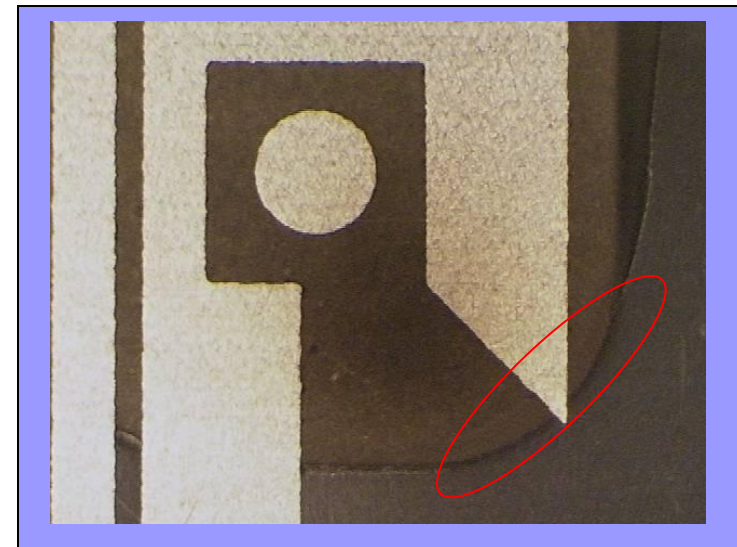
Adalah Penyebaran glue paste yang kurang sempurna

Spesifikasinya :

Penyebaran glue pastenya adalah $0\text{mm} < A \leq 2\text{mm}$



KONDISI "OK"



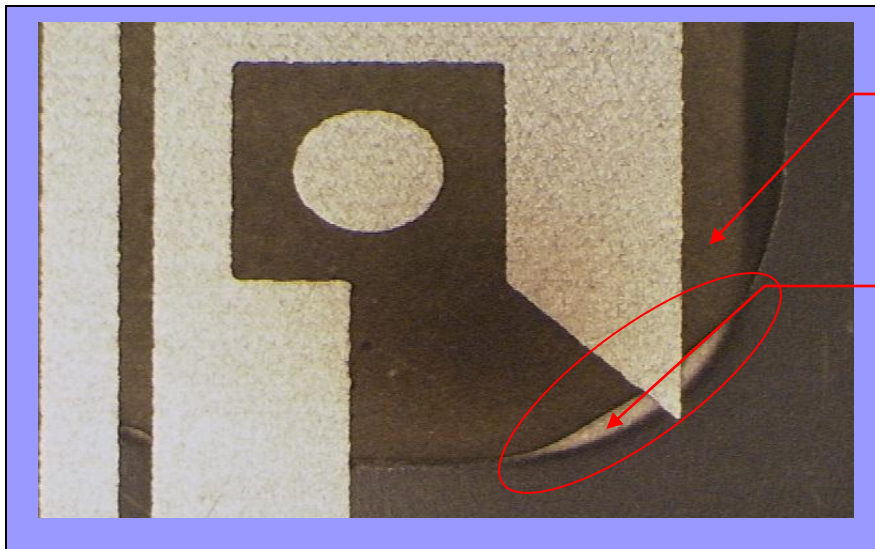
MARGINAL

9. GLUE PASTE INSUFFICATION

Adalah Penyebaran glue paste yang kurang sempurna

Spesifikasinya :

Penyebaran glue pastenya adalah $0\text{mm} < A \leq 2\text{mm}$



warna glue paste
pada permukaan
support plate

area yang tidak
terdapat glue paste
pada tepian support
plate.

KONDISI "NG"

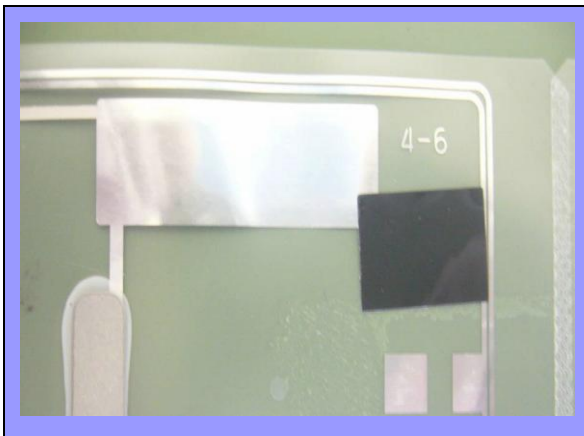
Dikatakan NG jika glue tidak terisi
di tepian/ujung support plate

10. NG LABEL

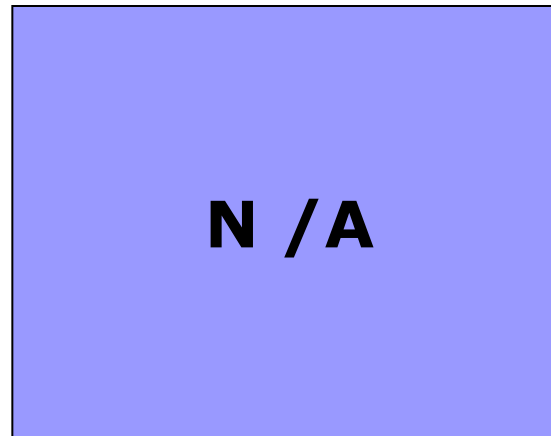
Adalah Label yang berfungsi untuk memberikan tanda pada material yang NG (Not Good)

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada produk NG tanpa NG label



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

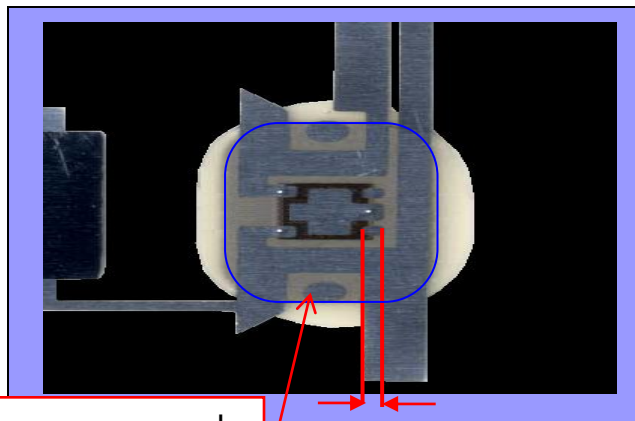
Ditemukan Fail Product tapi tidak terdapat NG Label (hanya marker)
Jika ditemukan kondisi demikian harus di beri NG Label

11. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA II)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

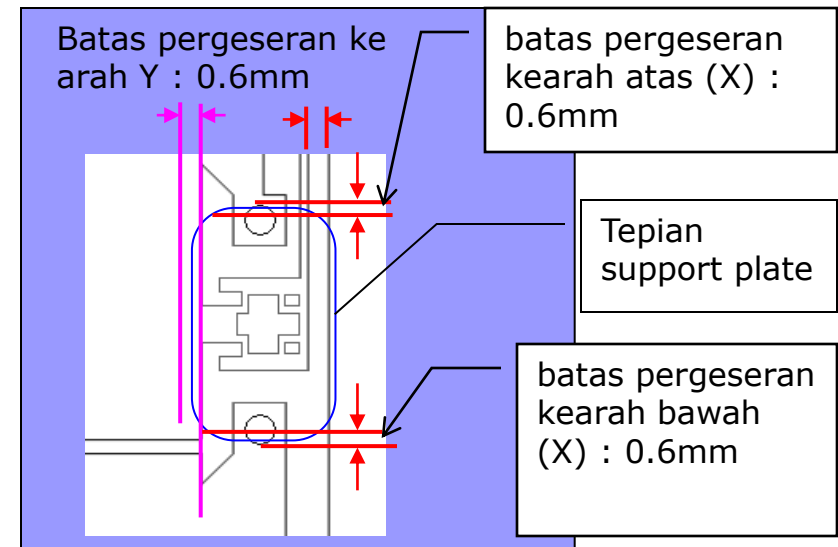
Tidak diijinkan jika support plate bergeser kearah X (kanan/kiri) jaraknya melebihi dan jika bergeser kearah Y (atas/bawah) jaraknya melebihi " Yen Pattern "



standar posisi pergeseran arah Y, sebesar 0.6mm dari ujung bulatan "yen pattern" ini

KONDISI "OK"

A



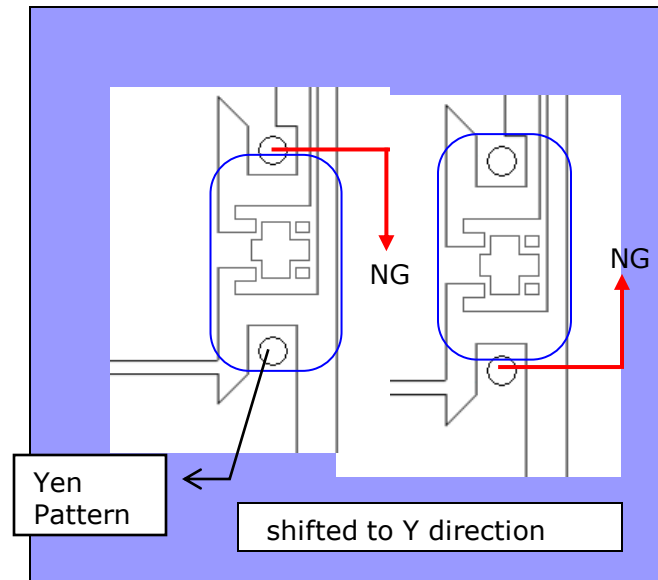
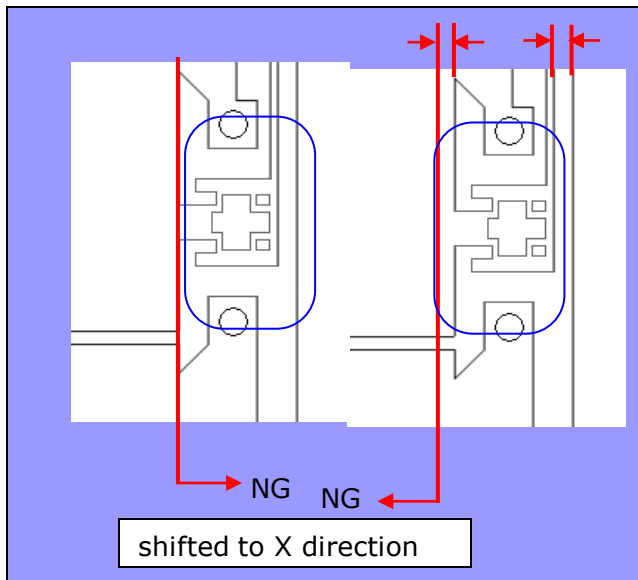
MARGINAL

11. MISPLACE SUPPORT PLATE (SUICA II)

Adalah Penempatan support plate yang tidak sejajar

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika support plate bergeser kearah X (kanan/kiri)
jaraknya melebihi dan jika bergeser kearah Y (atas/bawah)
jaraknya melebihi " Yen Pattern " ($> 0.6\text{mm}$)



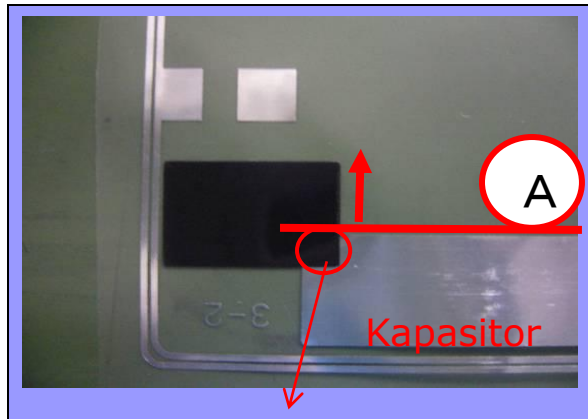
KONDISI "NG"

12. NG LABEL POSITION

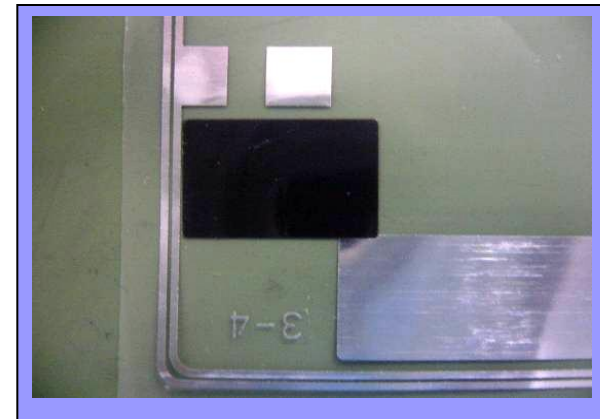
Adalah Letak NG label yang seharusnya ditempelkan

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan NG label berada pada batas luar deteksi sensor, tidak sejajar dengan kapasitor pattern dan ada celah pada NG label



Posisi NG Label menindih/mengenai kapasitor pattern dengan jarak 3mm kearah vertical dan horisontal



Posisi NG Label berada diatas kapasitor pattern (standard limit atas)

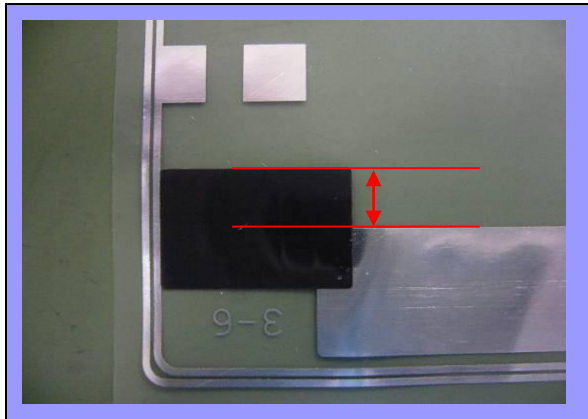
KONDISI"OK"

12. NG LABEL POSITION

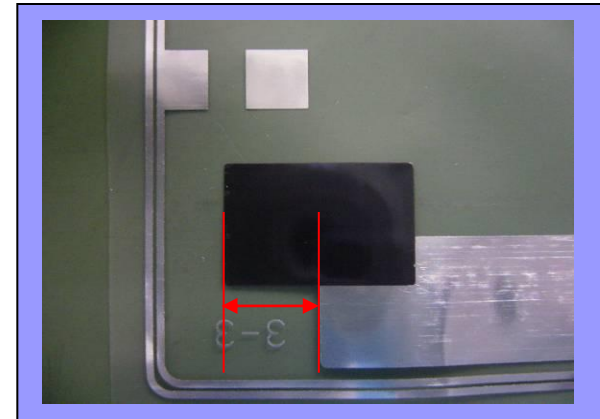
Adalah Letak NG label yang seharusnya ditempelkan

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan NG label berada pada batas luar deteksi sensor, tidak sejajar dengan kapasitor pattern dan ada celah pada NG label



Posisi NG Label berada 1/2 dari tinggi label terhadap kapasitor pattern.(standar limit bawah)



Posisi NG Label berada 1/2 dari lebar label terhadap kapasitor pattern (standar limit kanan)

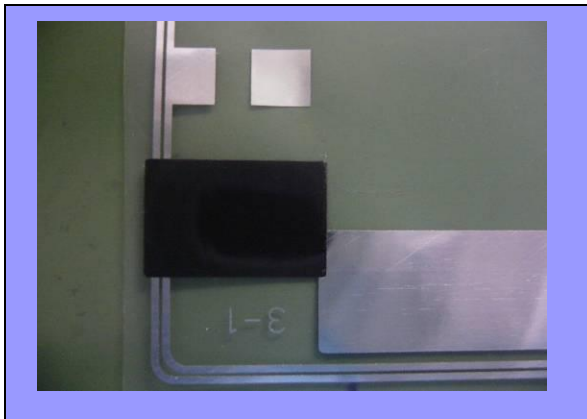
KONDISI"OK"

12. NG LABEL POSITION

Adalah Letak NG label yang seharusnya ditempelkan

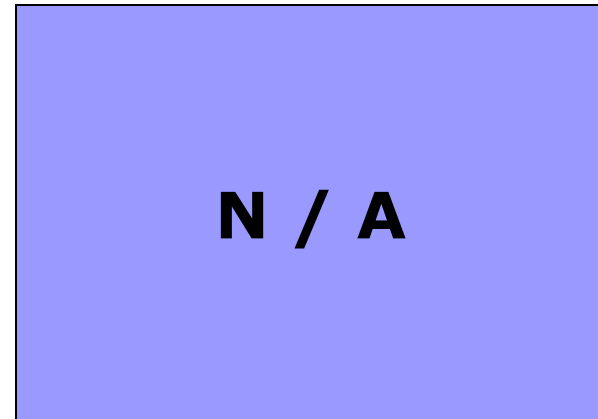
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan NG label berada pada batas luar deteksi sensor, tidak sejajar dengan kapasitor pattern dan ada celah pada NG label



Posisi NG Label berada tepat
di sisi kiri kapasitor pattern
(standar limit kiri)

KONDISI"OK"



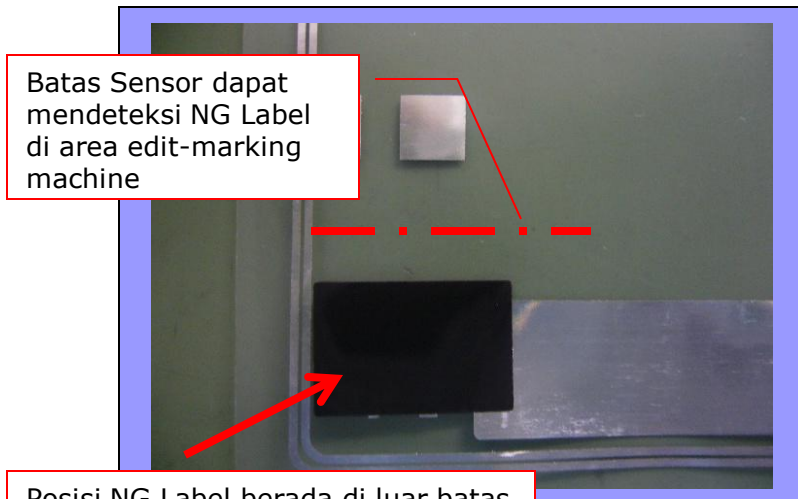
MARGINAL

12. NG LABEL POSITION

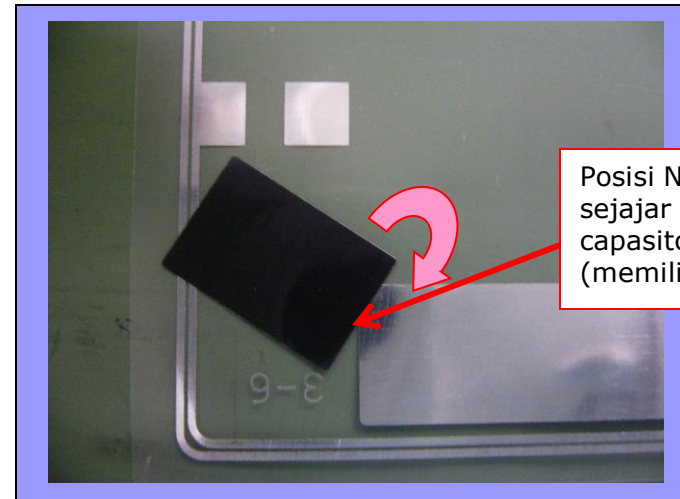
Adalah Letak NG label yang seharusnya ditempelkan

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan NG label berada pada batas luar deteksi sensor, tidak sejajar dengan kapasitor pattern dan ada celah pada NG label



Posisi NG Label berada di luar batas deteksi sensor , sehingga tidak dapat mendeteksi NG product saat process Edit-marking.



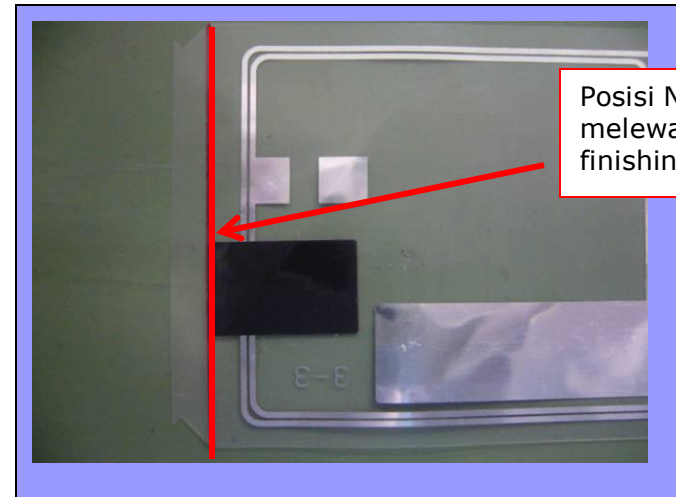
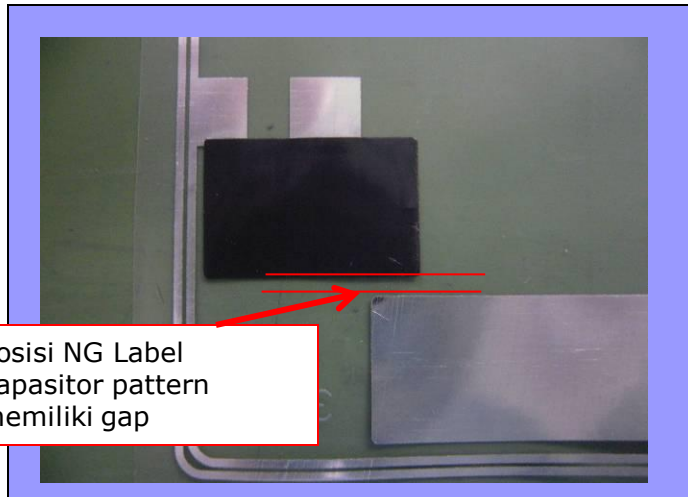
KONDISI "NG"

12. NG LABEL POSITION

Adalah Letak NG label yang seharusnya ditempelkan

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan NG label berada pada batas luar deteksi sensor, tidak sejajar dengan kapasitor pattern dan ada celah pada NG label



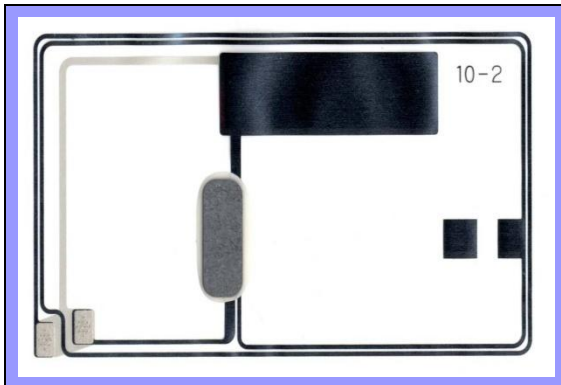
KONDISI "NG"

13. WRINKLE

Adalah adanya kerutan pada antenna sheet

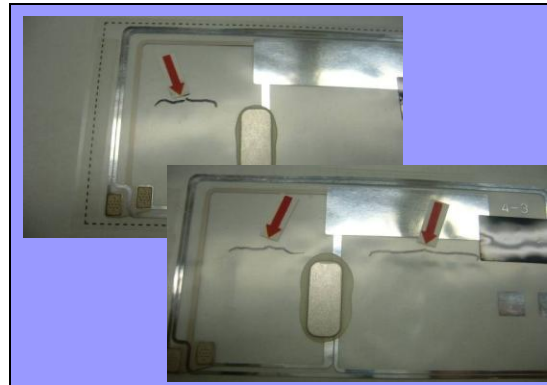
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada kerutan / lekukan pada permukaan sheet



Tidak terdapat wrinkle pada sheet

KONDISI"OK"



Ditemukan kondisi wrinkle pada sheet, tetapi posisinya hanya pada salah satu & hanya dapat dilihat dg angle tertentu

MARGINAL



Ditemukan kondisi wrinkle pada permukaan sheet, tetapi posisinya pada semua sisi permukaan & terlihat dg jelas

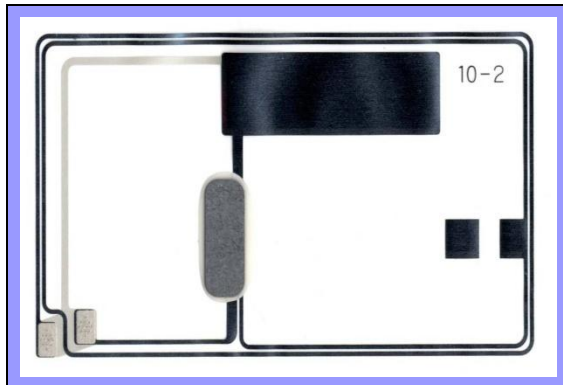
KONDISI"NG"

14. FOREIGN MATERIAL PADA ANTENNA PATTERN

Adalah adanya kotoran pada antenna pattern

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada kerutan / lekukan pada permukaan sheet



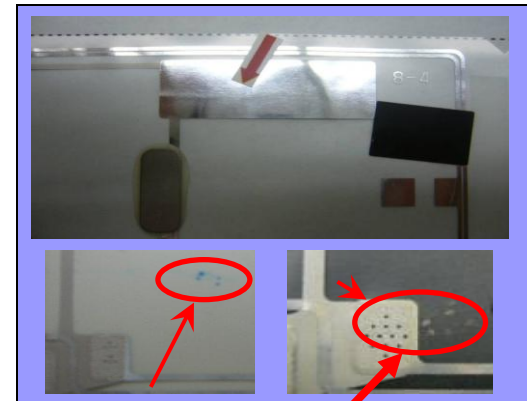
Tidak terdapat kotoran pada sheet

KONDISI"OK"



Terdapat kotoran di permukaan antenna sheet pattern, tetapi kondisi warnanya tidak berubah

MARGINAL



Terdapat kotoran di permukaan antenna sheet / pattern berupa stain (noda), remain silver paste, scratch yg menyebabkan perubahan warna patternnya

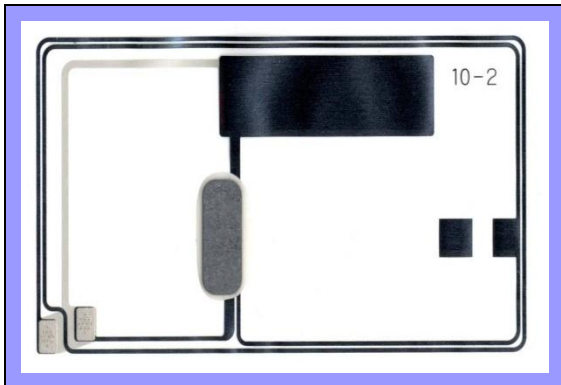
KONDISI"NG"

15. FOREIGN MATERIAL DIATAS SHEET

Adalah adanya kotoran diatas antenna sheet

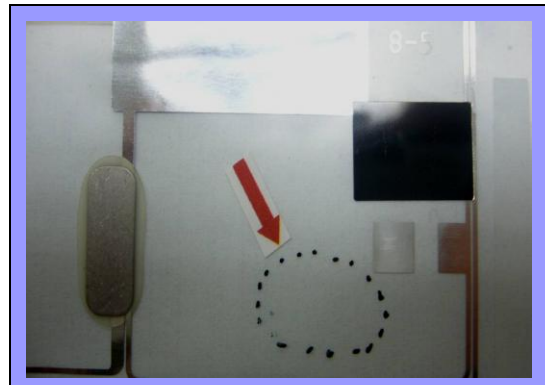
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada kotoran bekas penempelan support plate pada sheet (warna coklat)



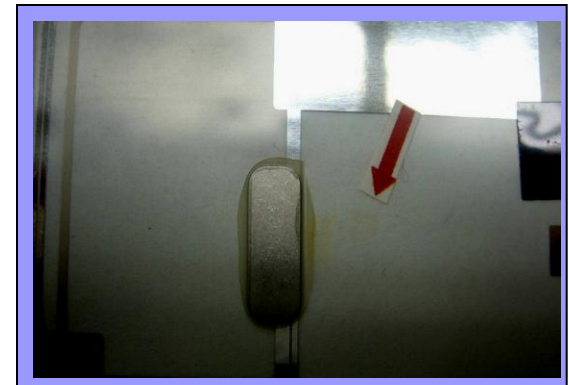
Tidak terdapat kotoran bekas penempelan support plate pada sheet

KONDISI"OK"



Terdapat bekas wet cleaning / clear water tapi kondisinya tipis & lebarnya lebih kecil dari kapasitor pattern

MARGINAL



Terdapat noda bekas proses penempelan support plate (warna coklat terang yg terlihat jelas & tidak dapat hilang setelah dibersihkan

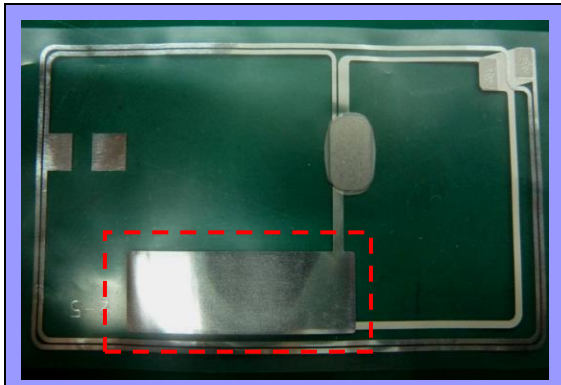
KONDISI"NG"

16. SCRATCH ON CAPASITOR PATTERN

Adalah adanya goresan di area kapasitor pattern

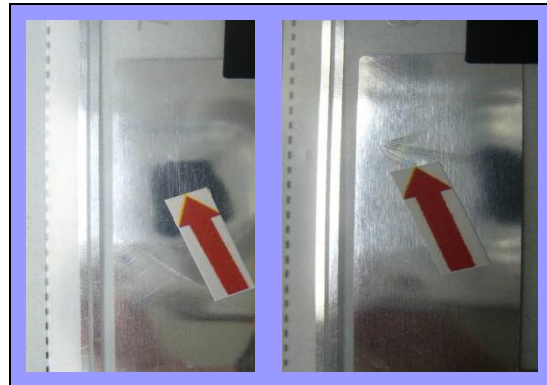
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada goresan sampai terlihat PET nya



Tidak ditemukan goresan / scratch di
pattern area / kapasitor pattern

KONDISI"OK"



Ditemukan goresan/ scratch di area
kapasitor pattern tetapi bentuk &
ukurannya tipis

MARGINAL



Ditemukan scratch di area kapasitor pattern
ukurannya besar & mengenai seluruh
permukaan & dalam sampai terlihat lapisan
PET nya & dapat dilihat dari 3 posisi :
atas, samping, depan

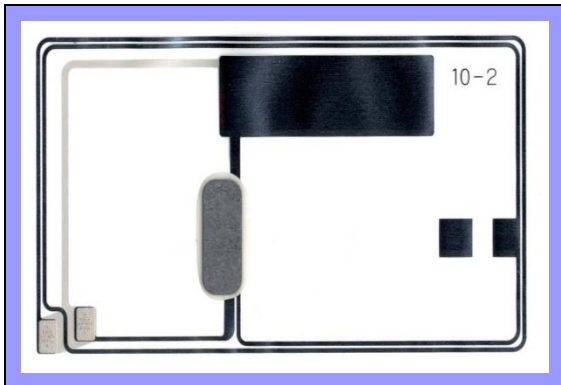
KONDISI"NG"

17. BREAKING (PUSH MARK ON FILM)

adalah adanya jejak patahan / breaking mark di permukaan antenna sheet

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya breaking mark yang jelas pada permukaan antenna sheet dari semua angle / sisi



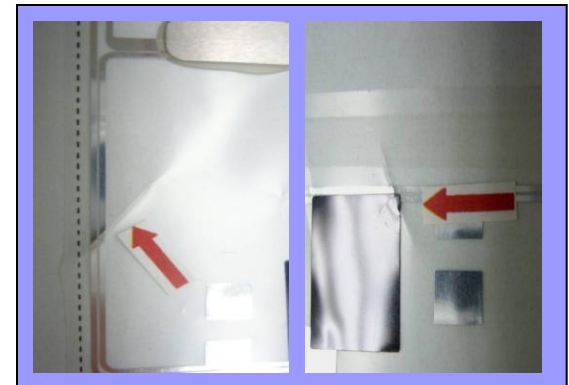
Tidak ditemukan jejak patahan (breaking mark) di permukaan antenna sheet

KONDISI"OK"



Ditemukan breaking mark pada permukaan antenna sheet, tetapi hanya bisa dilihat dengan angle tertentu & tidak mengenai antenna sheet (breaking marknya tipis)

MARGINAL



Ditemukan breaking mark di permukaan antenna sheet & terlihat jelas pada semua sisi / angle serta mengenai antenna pattern

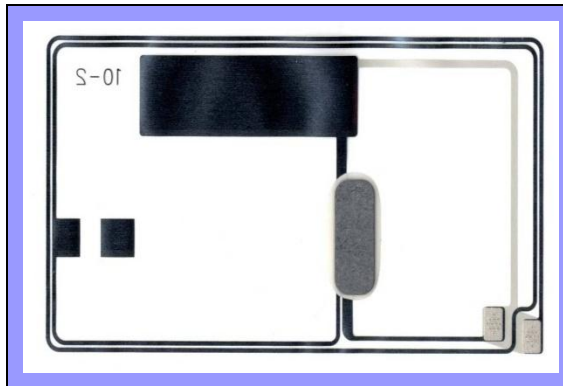
KONDISI"NG"

18. BREAKING MARK ON PATTERN

Adalah adanya jejak patahan / breaking mark di permukaan Aluminium pattern

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya breaking mark yang dalam dan merusak aluminum pattern



Tidak ditemukan breaking mark pada area aluminium pattern

KONDISI"OK"



Ditemukan breaking mark pada area aluminium pattern, tetapi bentuknya tipis / tidak merusak aluminium pattern

MARGINAL



Ditemukan breaking mark pada area aluminium pattern, dalam & merusak aluminium pattern

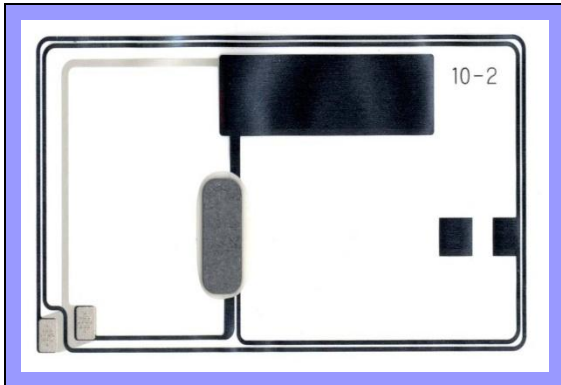
KONDISI"NG"

19. SILVER PASTE

Adalah adanya silver paste remain pada area antenna sheet

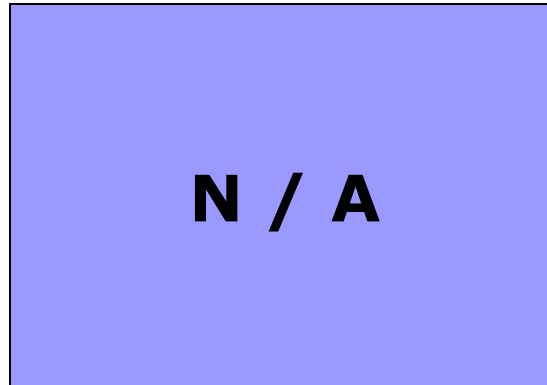
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya silver paste remain pada permukaan antenna sheet

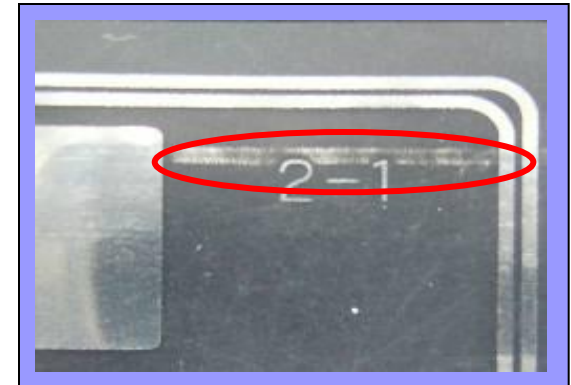


Tidak terdapat silver paste remain pada area antenna sheet

KONDISI"OK"



MARGINAL



Terdapat silver paste remain pada permukaan antenna sheet

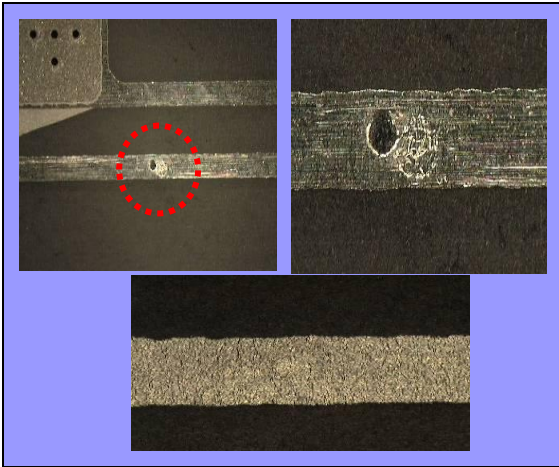
KONDISI"NG"

20. PUSH MARK

Adalah adanya push mark pada aluminium pattern

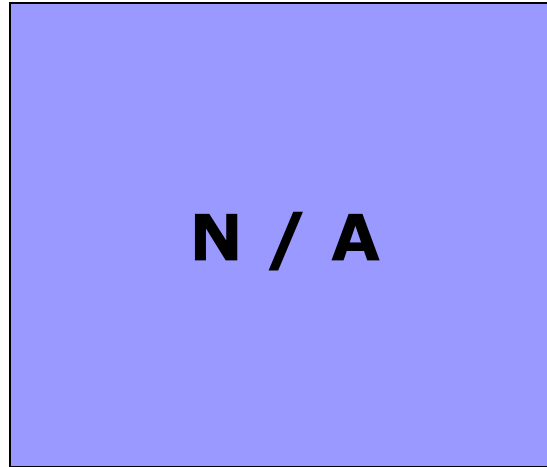
Spesifikasinya :

**Tidak diijinkan adanya push mark pada area Al Pattern
jika ukurannya > Al pattern line**

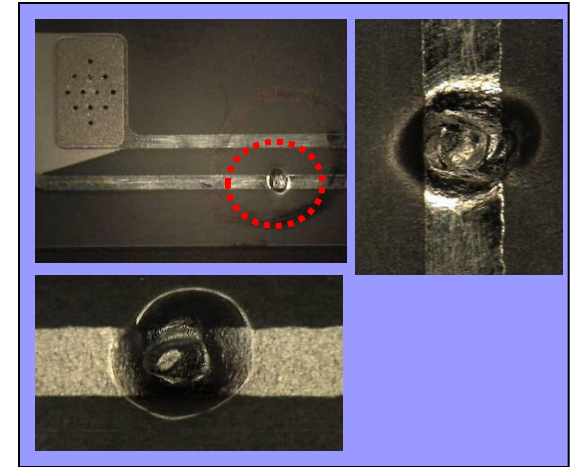


Tidak terdapat push mark & kondisi
push mark ukurannya < dari ukuran
Al pattern line

KONDISI"OK"



MARGINAL



Terdapat push mark di area Al pattern &
bentuknya > Al pattern line & bila ditemu
kan diarea kapasitor pattern & silver paste
area dg kondisi yang sama maka
adusmentnya NG

KONDISI"NG"

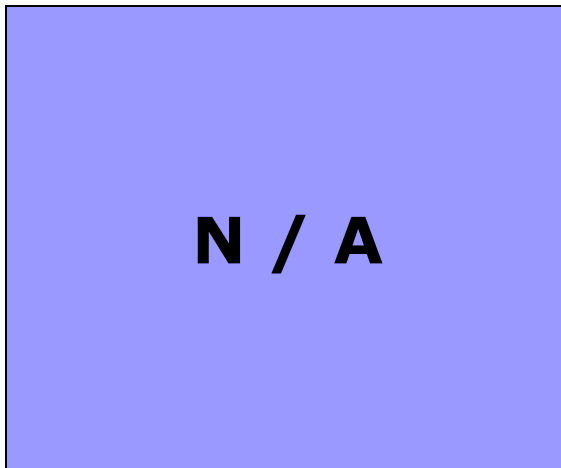
33

21. ANTENNA SHEET PATTERN (PATTERN COLOUR)

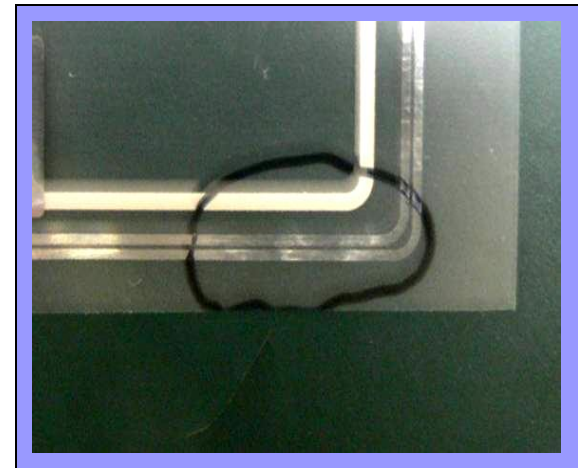
Adalah adanya warna antenna sheet yang tidak cerah

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya warna antenna pattern buram atau antenna sheet harus cerah



MARGINAL



Ditemukan kondisi warna antenna pattern buram (blurr) tidak mengkilap karena adanya noda / kotoran

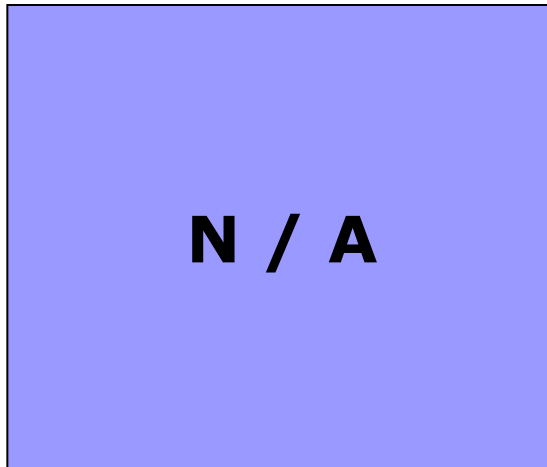
KONDISI "NG"

22. ANTENNA SHEET PATTERN (PATTERN STAIN)

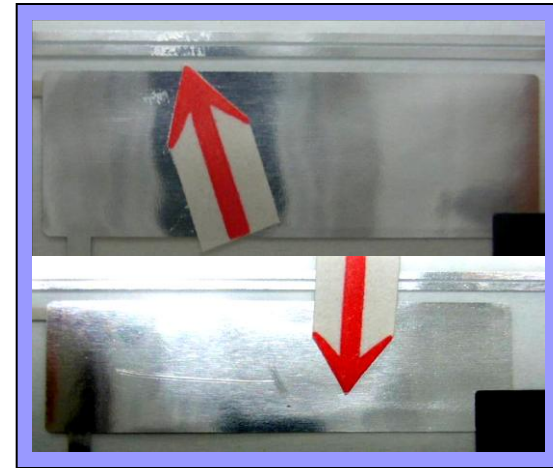
Adalah adanya stain / noda di area capasitor pattern

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya stain / noda di area capasitor pattern



MARGINAL



Ditemukan kondisi pada antenna sheet pattern terdapat stain / noda di area capasitor pattern antenna circuit

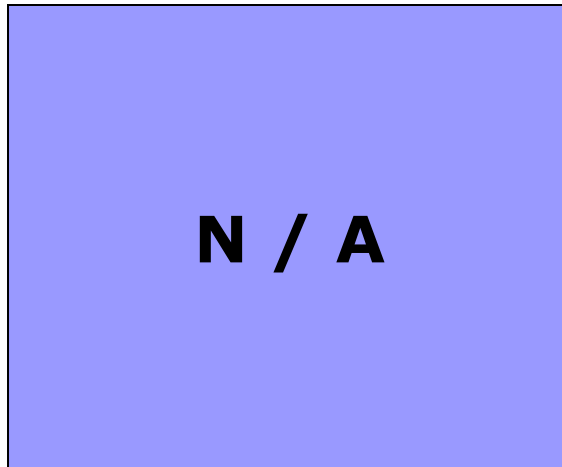
KONDISI"NG"

23. ANTENNA SHEET PATTERN (PATTERN SCRATCH / MARK)

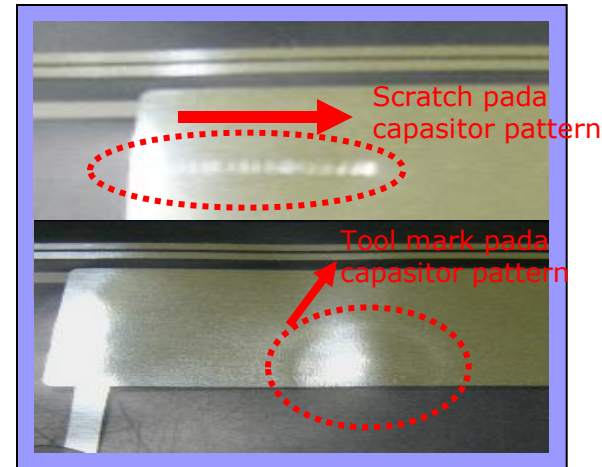
Adalah adanya tool mark pada capasitor pattern

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya tool mark pada capasitor pattern



MARGINAL



Ditemukan tool mark pada
posisi capasitor pattern

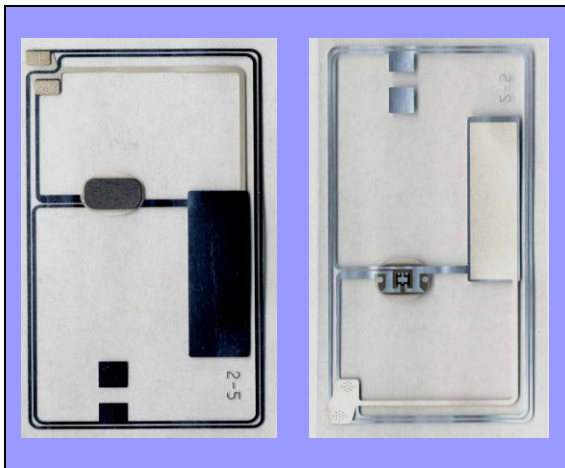
KONDISI"NG"

24. AG PASTE BLEED

Adalah adanya sisa ag paste yang keluar dari ag paste pattern

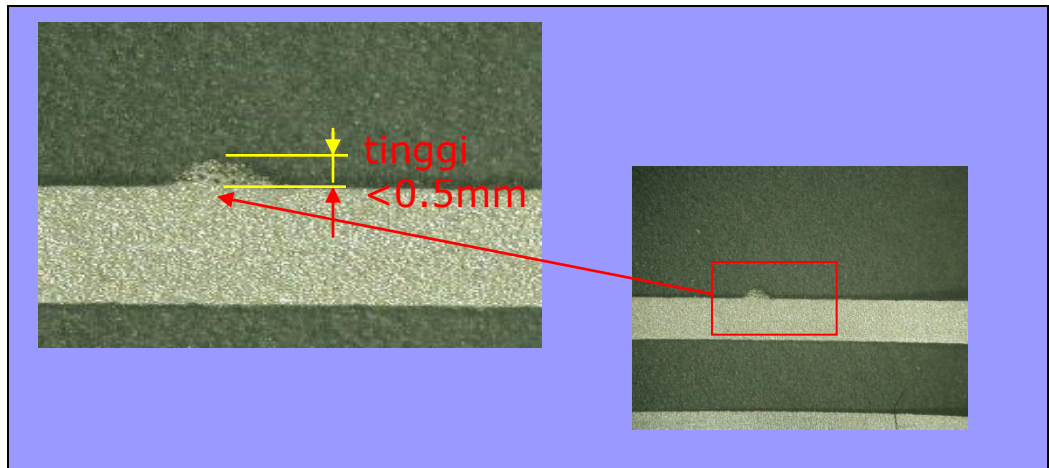
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya ag paste bleed spec tingginya $>0.5\text{mm}$



Tidak ditemukan Ag paste bleed di area ag paste pattern

KONDISI"OK"



Ditemukan Ag paste bleed dengan ukuran tinggi $< 0.5\text{mm}$

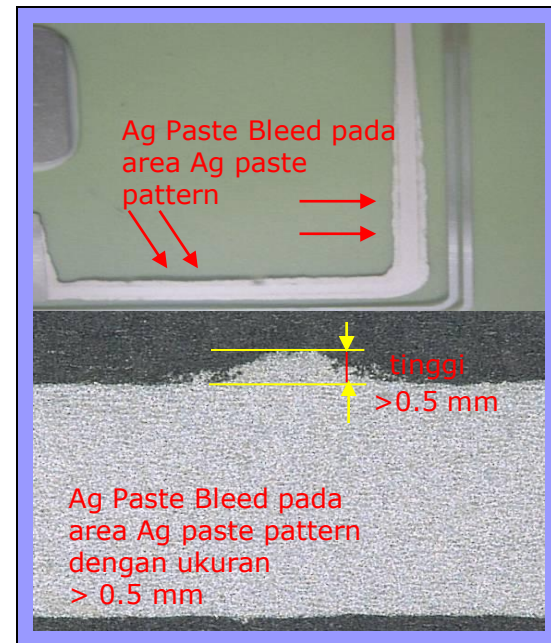
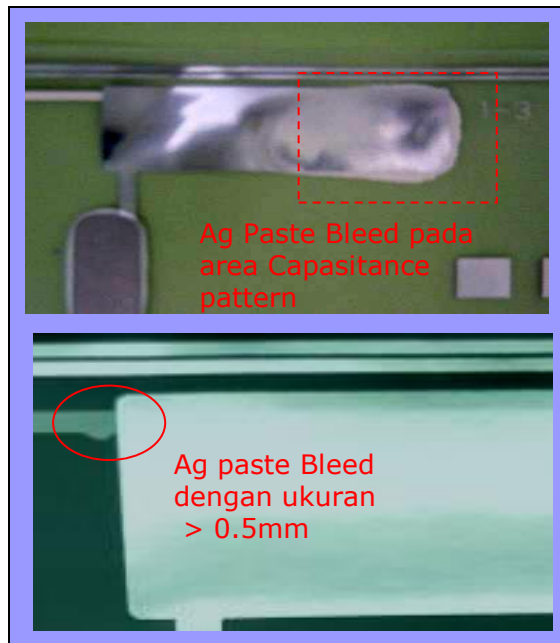
MARGINAL

24. AG PASTE BLEED

Adalah adanya sisa ag paste yang keluar dari ag paste pattern

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan adanya ag paste bleed spec tingginya $>0.5\text{mm}$



KONDISI"NG"

38

Reject Criteria Final Test

- 1. RESONANCE FREQUENCY NG**
- 2. COMMUNICATION NG**
- 3. RETENTION DATA NG**
- 4. LOAD MODULATION LEVEL NG**
- 5. MEMORY NG**
- 6. FUNCTION TEST NG**
- 7. TRANSPORTATION TROUBLE**

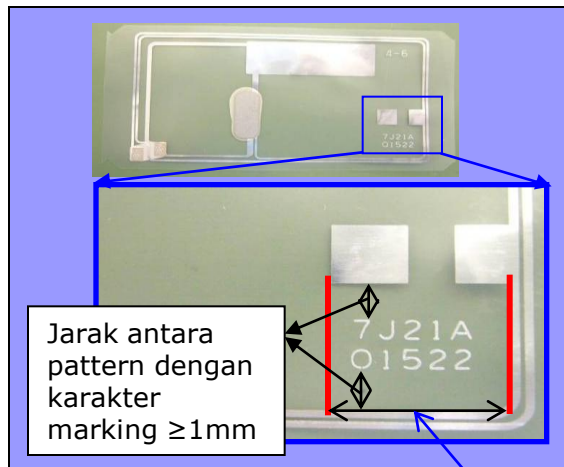
Reject Criteria Finishing Inspection

1. MARKING POSITION

Adalah Adanya Kondisi marking sudah sesuai dengan area yang ditentukan atau belum.

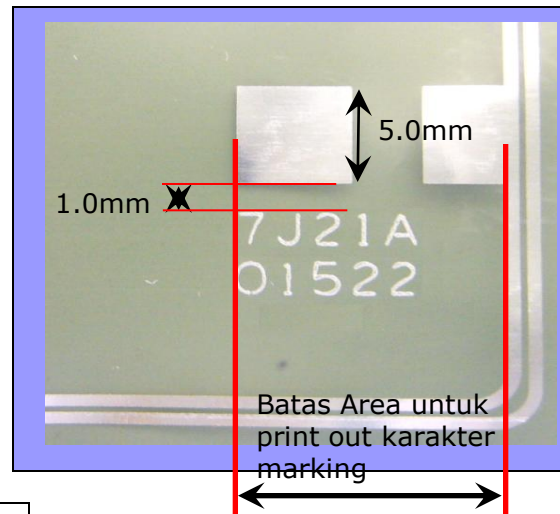
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika posisi marking sudah melebihi batas yang telah ditentukan



KONDISI "OK"

Batas Area untuk print out karakter marking



MARGINAL



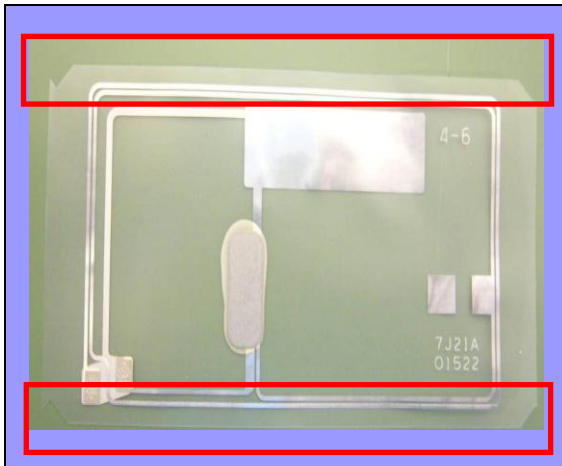
KONDISI "NG"

2. FILM EDGE SIDE BREAKING

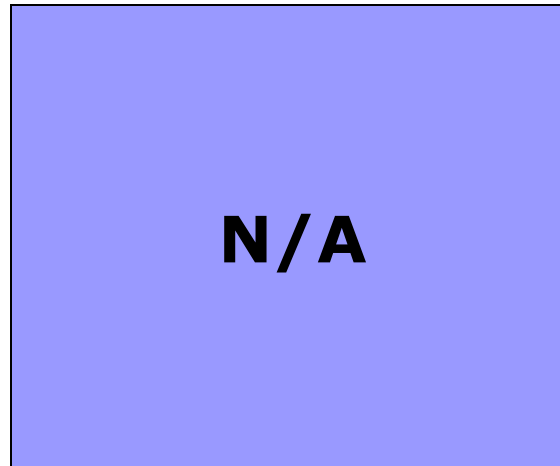
Adalah Adanya lipatan pada tepian sheet film

Spesifikasinya :

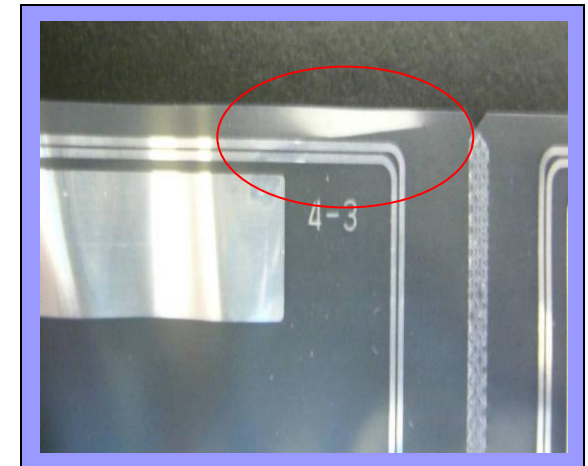
Tidak diijinkan adanya lipatan apapun di tepian sheet film



KONDISI "OK"



MARGINAL



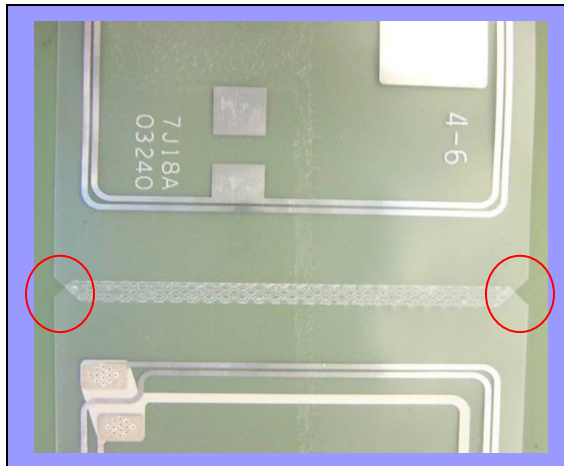
KONDISI "NG"

3. WELDING / CUTTING CONDITION

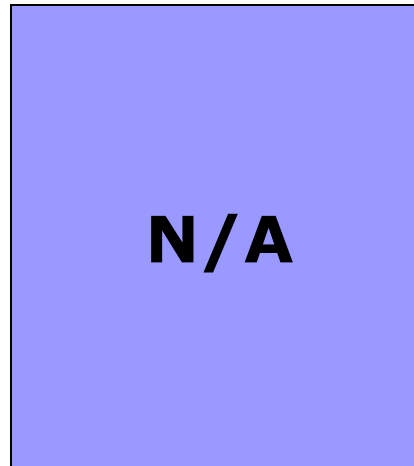
Adalah Kondisi cutting yang tidak berbentuk "V" karena hasil welding(sambungan) tidak sejajar dan tidak rapat.

Spesifikasinya :

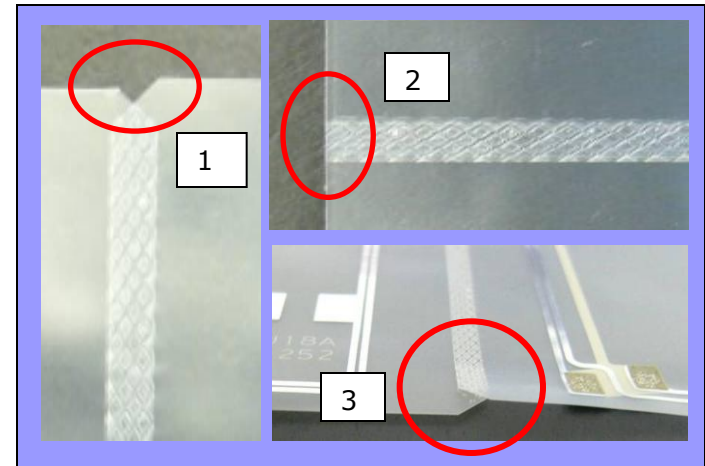
Tidak diijinkan adanya cutting yang tidak berbentuk "V" dan sambungan tidak sejajar dan tidak rapat.



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

4. NG LABEL

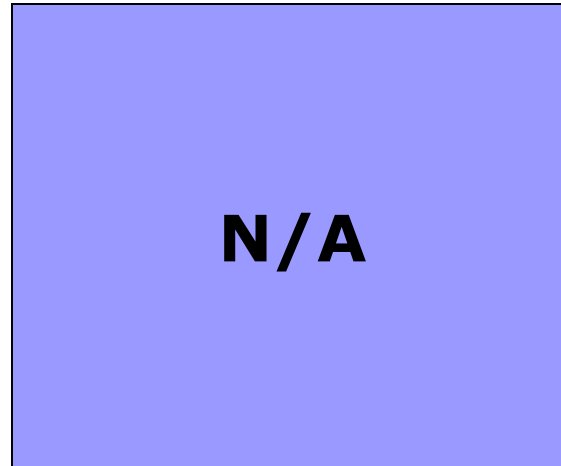
Adalah tidak adanya NG label pada produk fail tapi hanya ada tanda spidol.

Spesifikasinya :

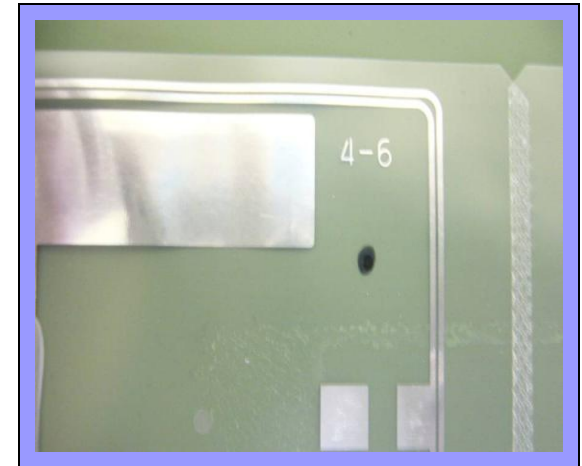
Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



KONDISI "OK"



MARGINAL



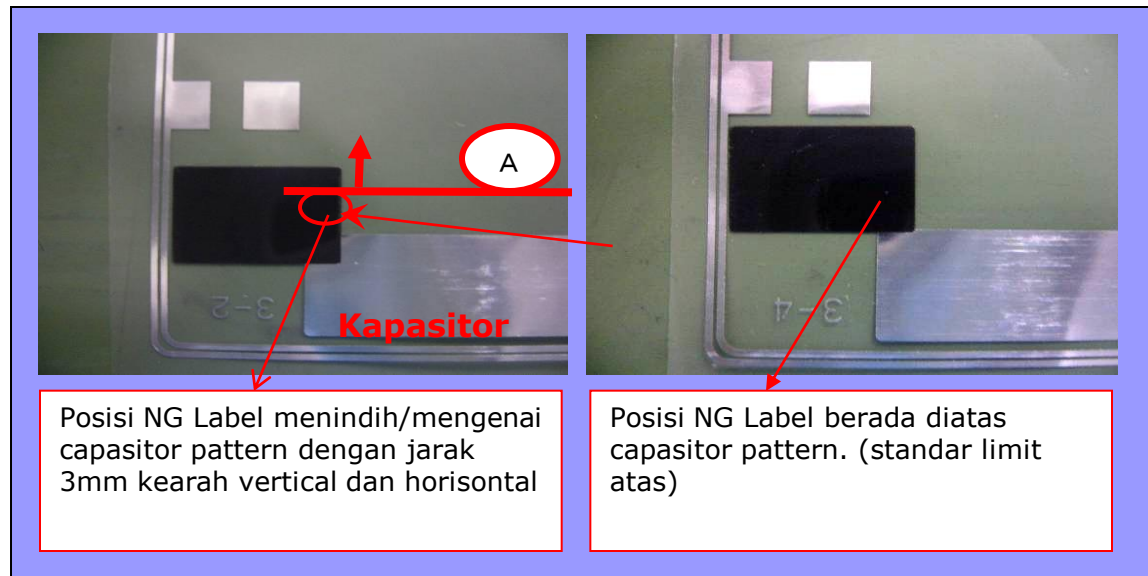
KONDISI "NG"

5. NG LABEL

Adalah tidak adanya NG label pada produk fail tapi hanya ada tanda spidol.

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



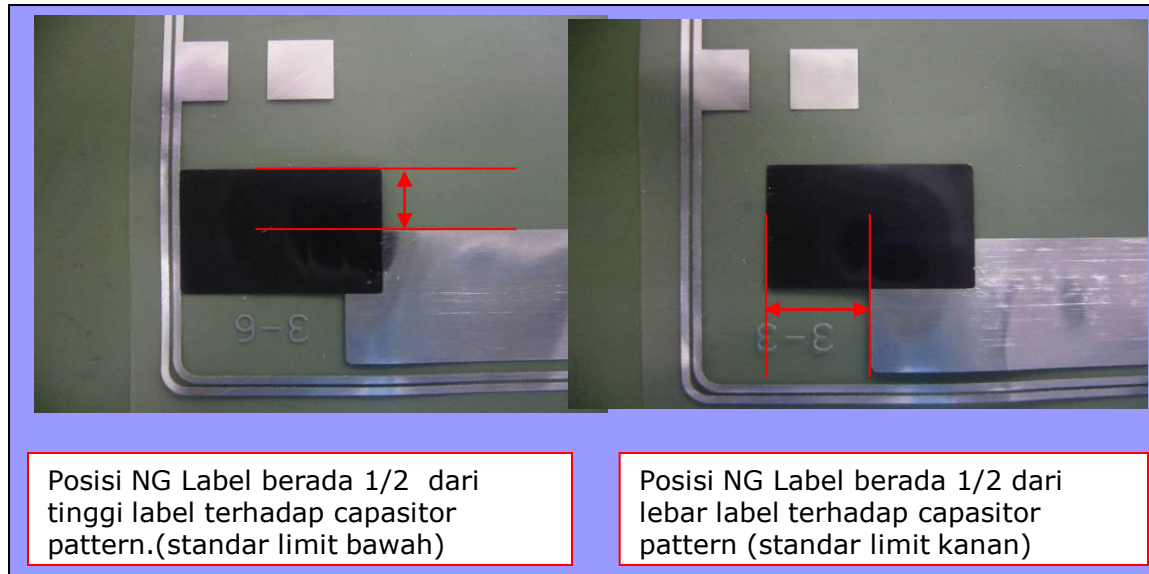
KONDISI"OK"

5. NG LABEL

Adalah tidak adanya NG label pada produk fail tapi hanya ada tanda spidol.

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



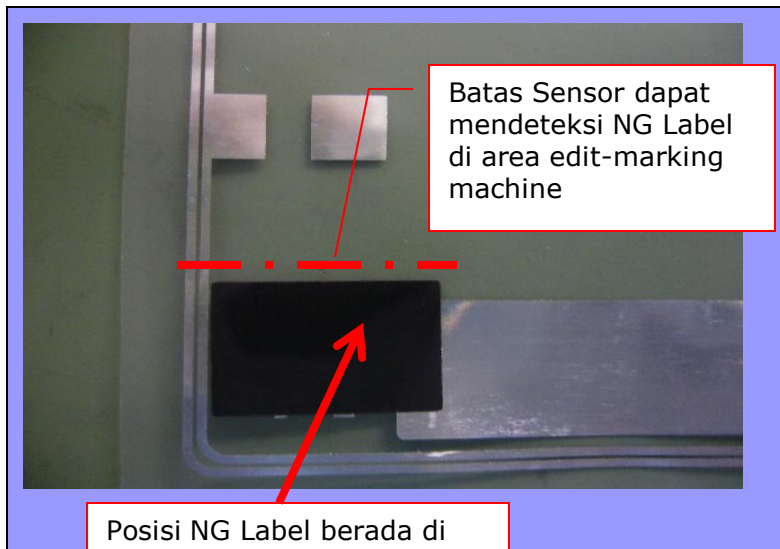
KONDISI"OK"

5. NG LABEL

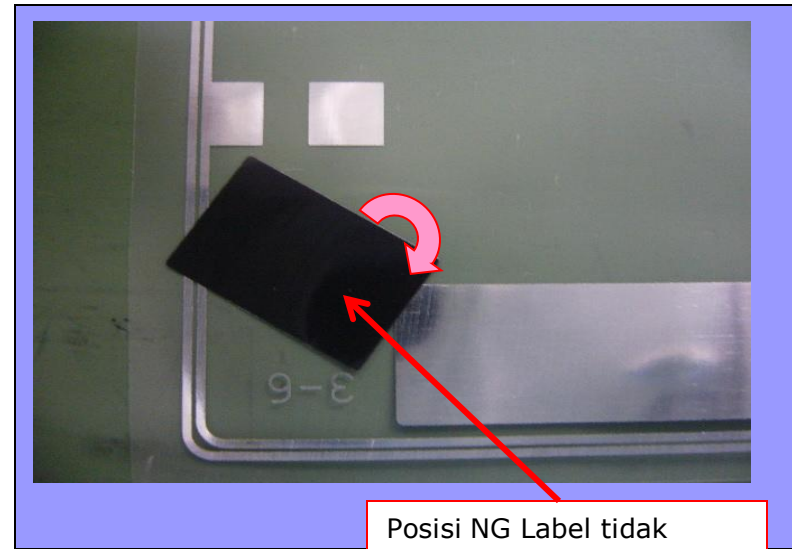
Adalah tidak adanya NG label pada produk fail tapi hanya ada tanda spidol.

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



Posisi NG Label berada di luar batas deteksi sensor , sehingga tidak dapat mendeteksi NG product saat process Edit-marking.



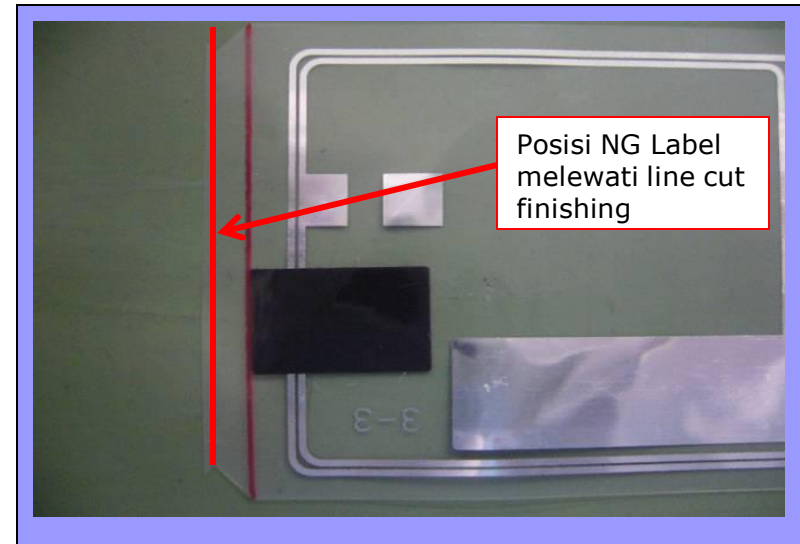
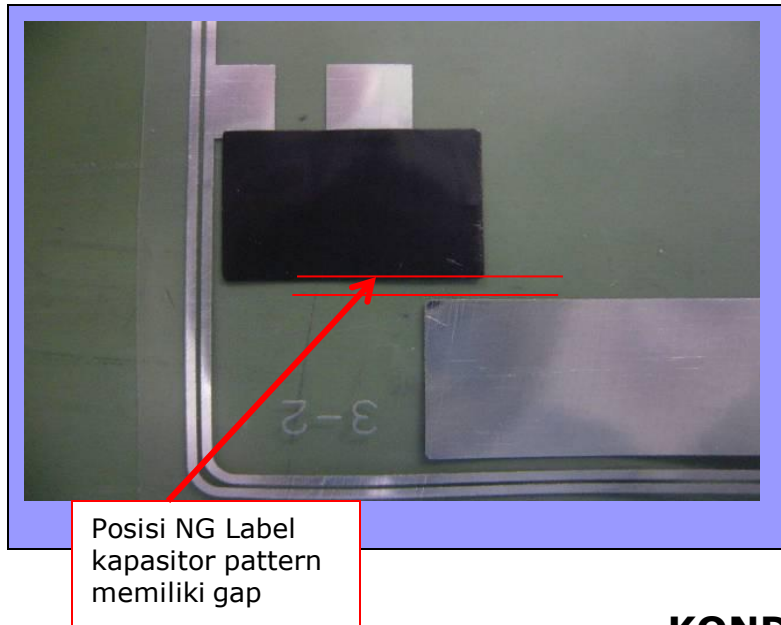
KONDISI"NG"

5. NG LABEL

Adalah tidak adanya NG label pada produk fail tapi hanya ada tanda spidol.

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



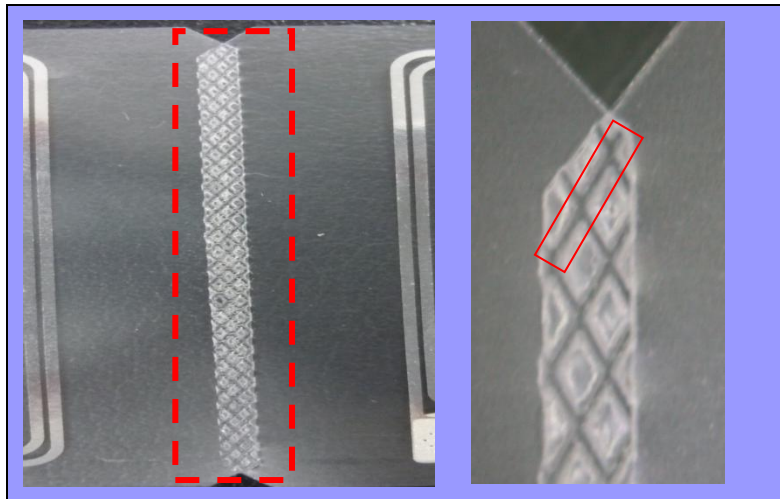
KONDISI "NG"

6. WELDING PATTERN

Adalah kondisi dimana welding pattern terlihat tidak merata dari atas hingga bawah serta kondisi patternnnya tidak mempunyai kedalaman.

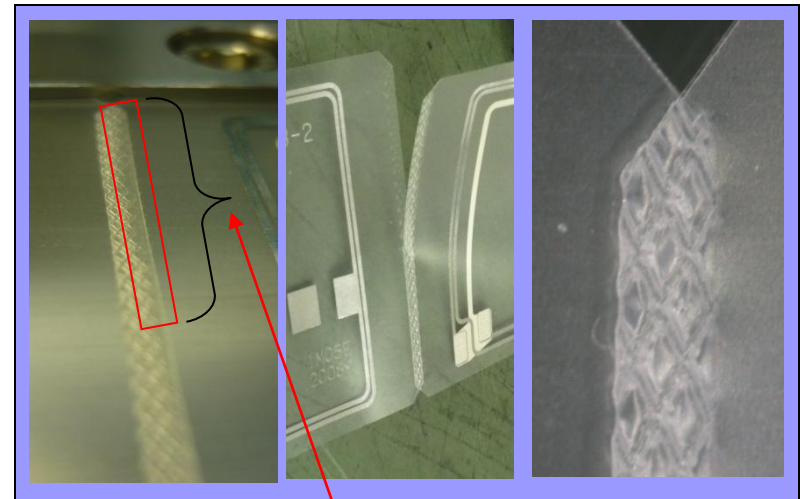
Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



kondisi pattern terlihat bersih & memiliki kedalaman

KONDISI"OK"



Jarak nya $\geq 1/2$ bagian area welding

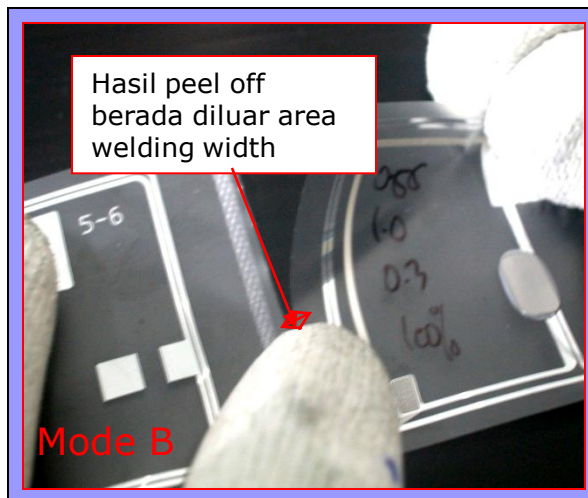
KONDISI"NG"

7. MANUAL TWISTED PEELING TEST MODE

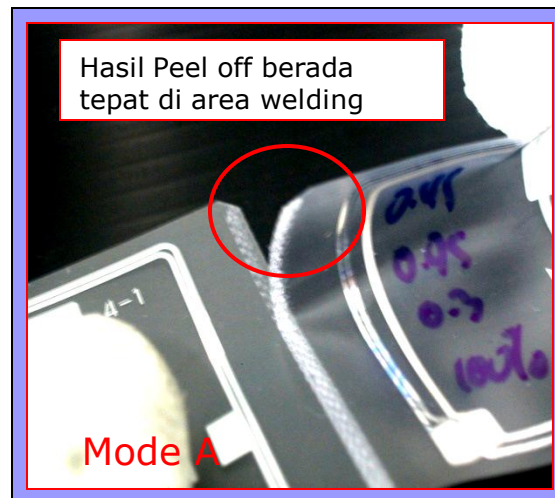
Adalah adanya peel off pada saat proses pengetesan peel strength dengan mode B / area welding yang peel off diluar welding joint area

Spesifikasinya :

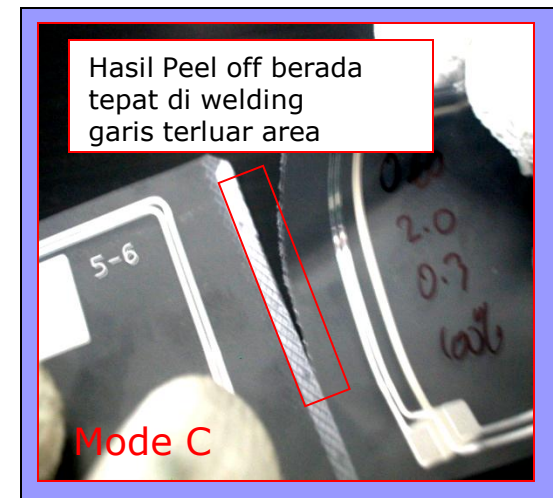
Tidak diijinkan jika tidak ada NG label pada produk fail



KONDISI"OK"



KONDISI"NG"



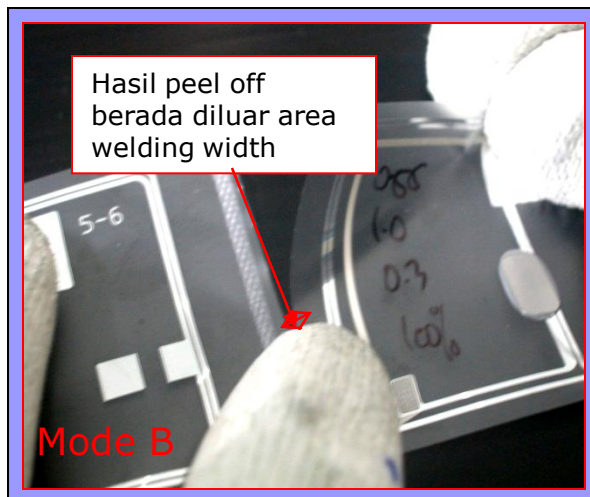
KONDISI"NG"

7. MANUAL TWISTED PEELING TEST MODE

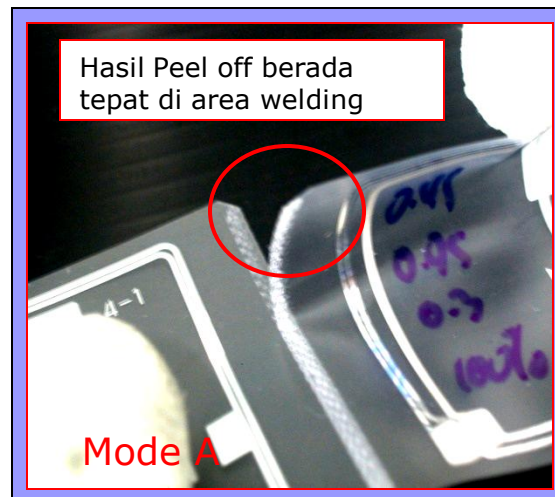
Adalah adanya peel off pada saat proses pengetesan peel strength dengan mode B / area welding yang peel off diluar welding joint area

Spesifikasinya :

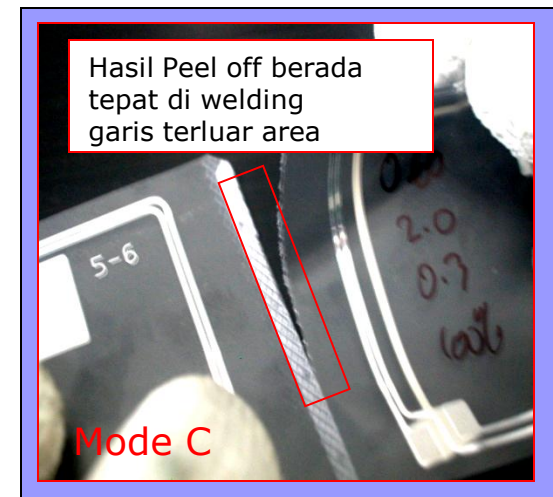
Tidak diijinkan jika peel off tepat berada di area welding pattern & digaris terluar area welding pattern



KONDISI "OK"



KONDISI "NG"



KONDISI "NG"

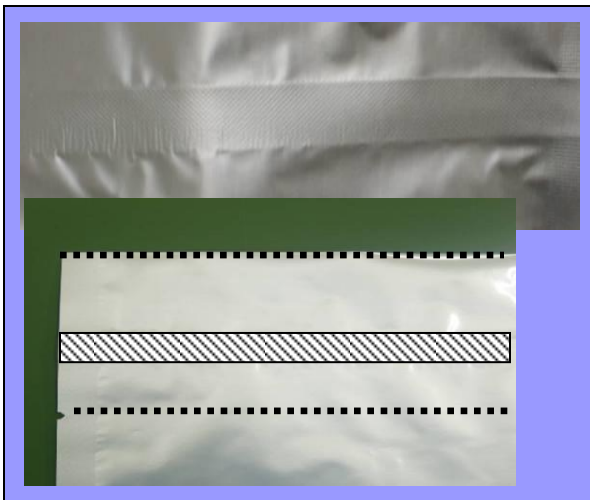
Reject Criteria Packing

1. HEAT SEALING

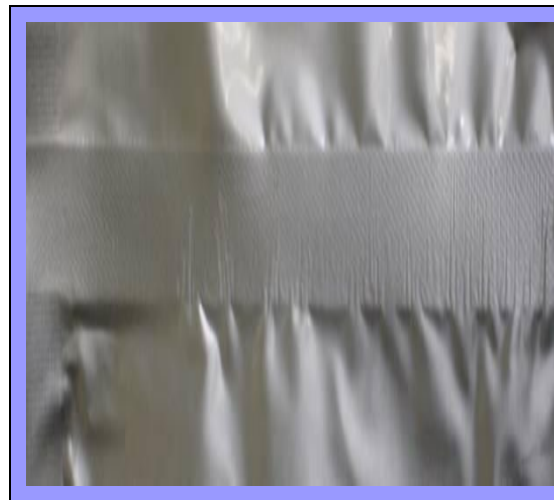
Adalah adanya lipatan / kerutan (wrinkle) pada hasil heat seal AL bag di area sealingan.

Spesifikasinya :

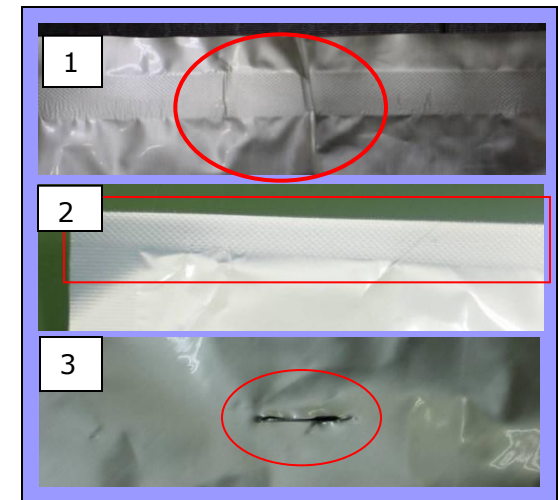
Tidak diijinkan jika ada kerutan / lipatan & sobek serta heat seal ada dibagian yang paling atas pada aluminium bag



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

1. VACUUM CONDITION

Adalah adanya keabnormalan bentuk reel yang tercetak pada aluminium bag

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika ada bentuk reel yang terlalu ketat, tidak tersealing & bocor



KONDISI "OK"



MARGINAL



KONDISI "NG"

3. LABEL POSITION

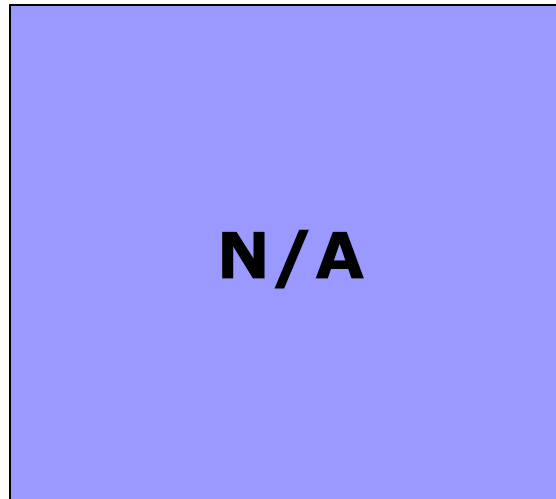
Adalah adanya keabnormalan pada saat penempelan label pada AL bag

Spesifikasinya :

Tidak diijinkan jika penempelan label pada AL bag tidak tepat di tengah



KONDISI"OK"



MARGINAL



KONDISI"NG"

Terima Kasih